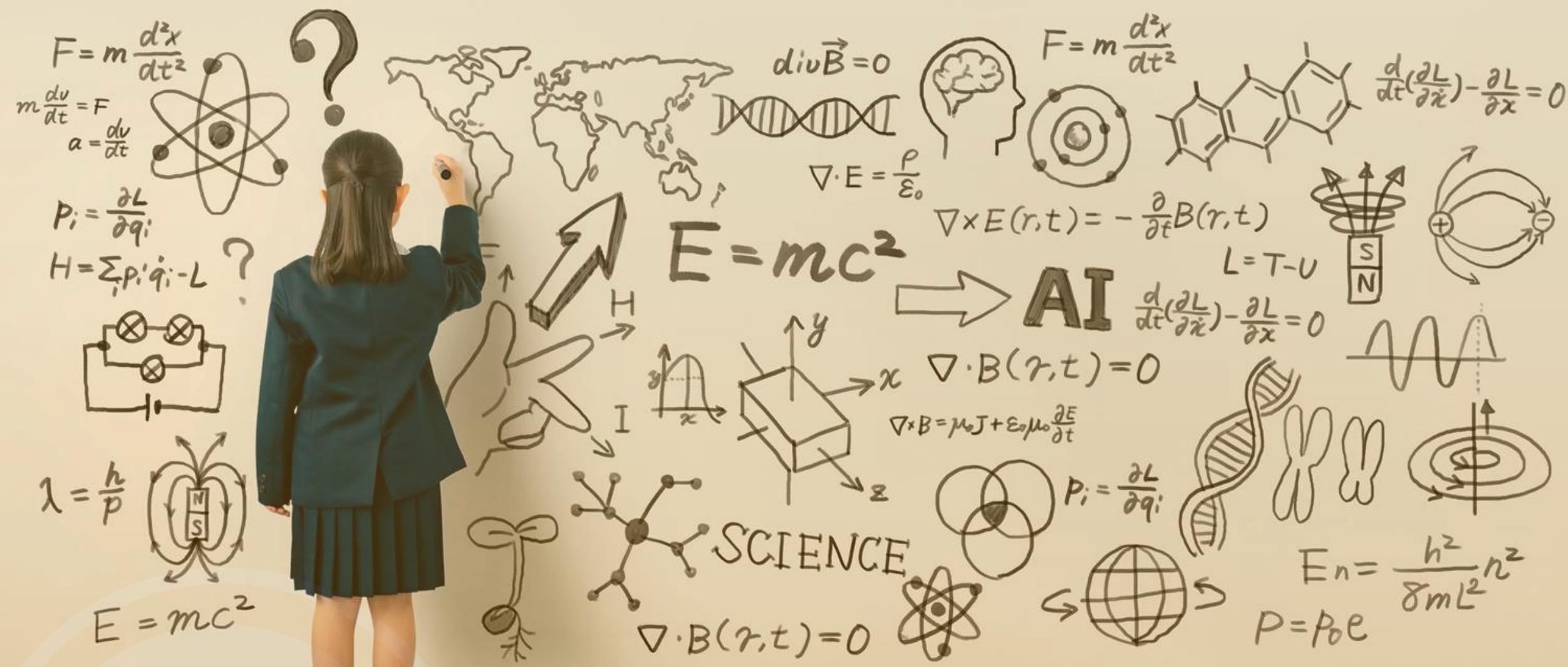




事業計画及び成長可能性に関する事項

株式会社クオルテック【証券コード：9165】

目 次

01 | 会社概要

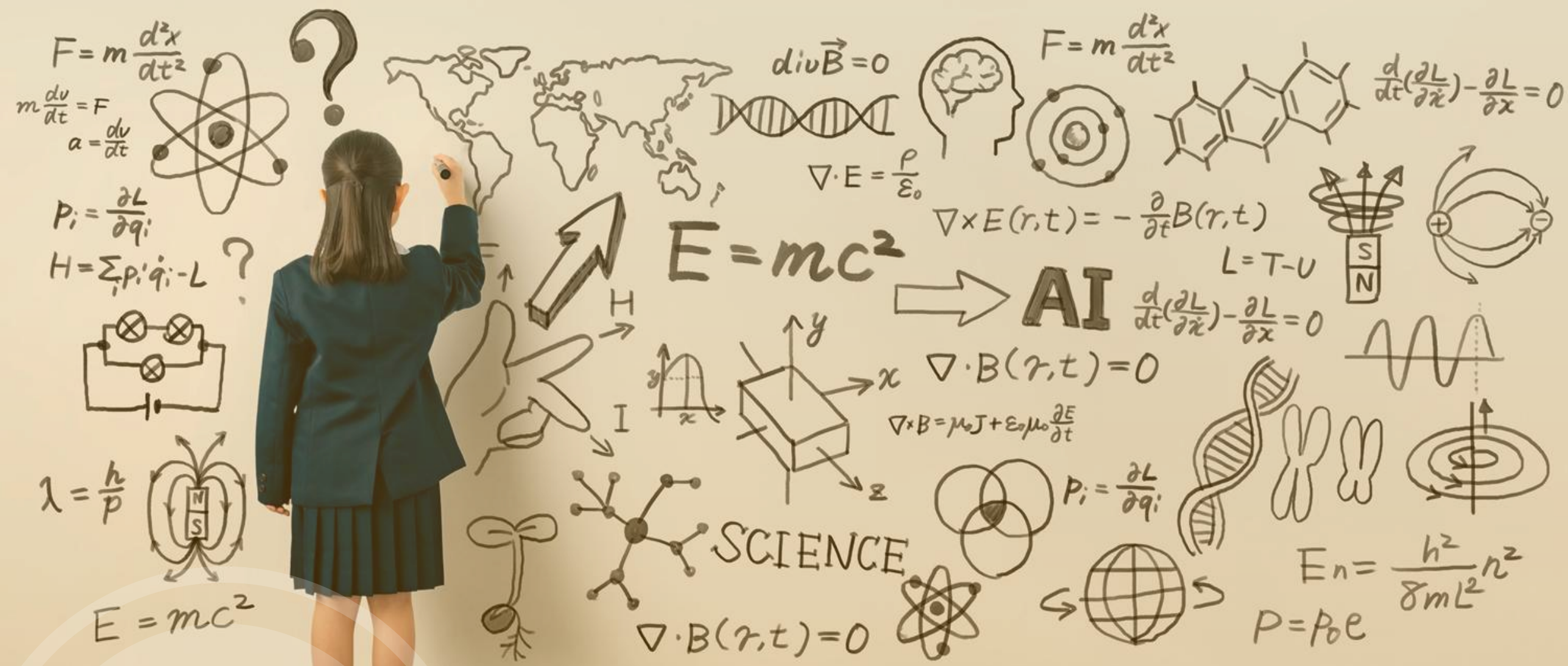
02 | 事業概要

03 | 成長戦略

04 | 業績見通し

05 | まとめ

06 | 附録

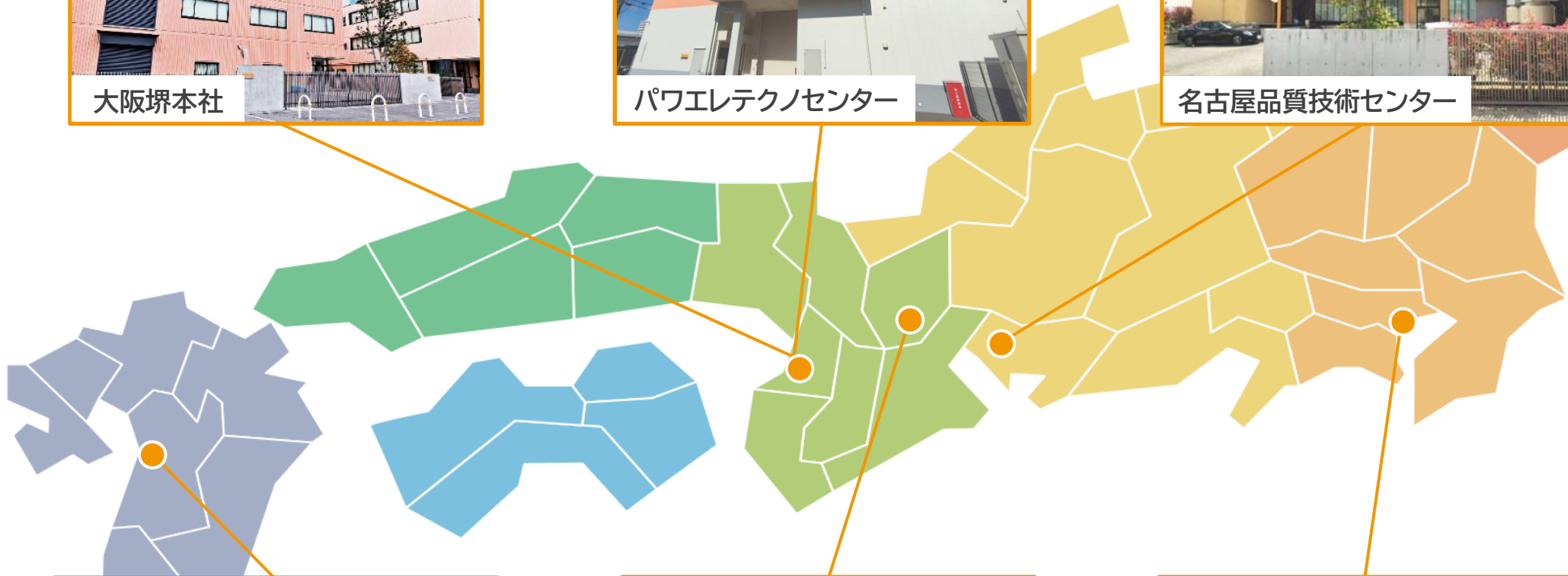


01 | 会社概要

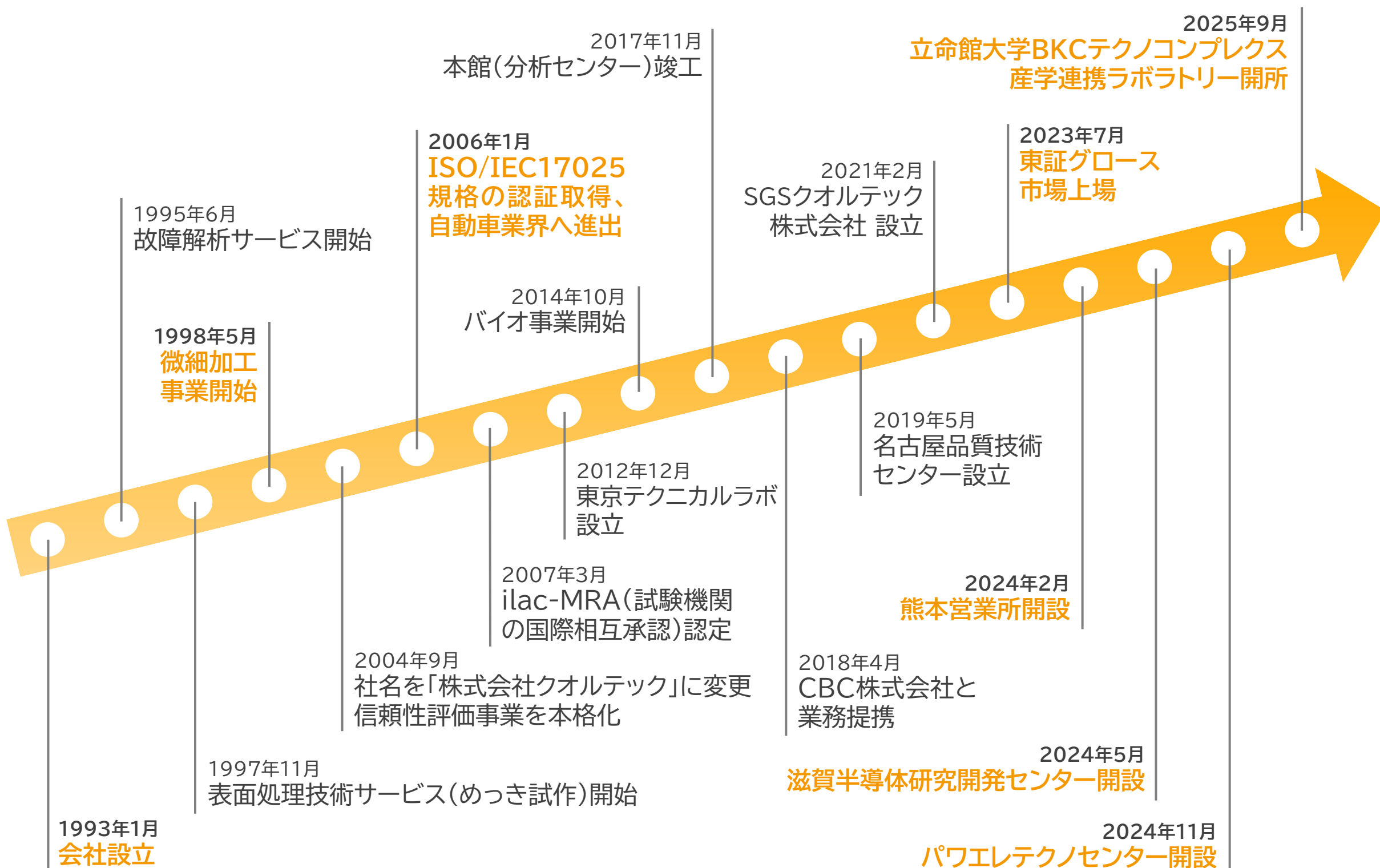
会社情報

社名	株式会社クオルテック(Qualtec Co., Ltd.)	
事業内容	●電子部品の不良解析・信頼性試験の受託および新技術の開発 ●品質管理を中心とした工場経営、実装技術に関するコンサルタント ●レーザ加工・表面処理(めっき)技術を中心とした微細加工 ●試験装置の設計・開発・製造・販売	
設立	1993年1月18日	
資本金	3億9,210万円	
従業員数	261名	
上場	東証グロース市場(証券コード:9165)	
本社所在地	〒590-0906 大阪府堺市堺区三宝町4丁230番地	
事業所 所在地	本館(分析センター)	〒590-0906 大阪府堺市堺区三宝町4丁231-1
	1号館(レーザ加工室・表面処理実験室)	〒590-0906 大阪府堺市堺区三宝町4丁230番地
	2号館(研磨センター)	〒590-0906 大阪府堺市堺区三宝町4丁231番地
	3号館(レーザ加工室)	〒590-0906 大阪府堺市堺区三宝町4丁234-1
	4号館&5号館	〒590-0906 大阪府堺市堺区三宝町4丁230番地
	6号館&7号館(信頼性試験センター)	〒592-8331 大阪府堺市西区築港新町3丁27-6
	8号館(バイオ事業部)	〒590-0905 大阪府堺市堺区鉄砲町32-1
	パワエレテクノセンター	〒593-8322 大阪府堺市西区津久野町1丁7-25
	名古屋品質技術センター	〒470-1123 愛知県豊明市西川町笹原28-8
	東京営業所	〒143-0013 東京都大田区大森南3-12-1
子会社	熊本営業所	〒860-0844 熊本県熊本市中央区水道町7-16 富士水道町ビル6F
	滋賀半導体研究開発センター	〒525-0058 滋賀県草津市野路東7-3-46 滋賀県立テクノファクトリー7号
子会社	株式会社やさしいAI研究所	〒573-0027 大阪府枚方市大垣内町2丁目17番3号
関連会社	SGSクオルテック株式会社	〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町3-5-12 御堂筋本町アーバンビル8F TEL:050-1780-7892(代表) FAX:06-6253-2704

事業所紹介



会社沿革



役員紹介



代表取締役社長

山口 友宏

2005年3月、株式会社クオルテック入社

2020年4月、代表取締役社長就任(現職)

「まず感謝する。これ以上に、創造性や生産性を高めるのに重要な事はない。」

代表取締役会長

志方 廣一

取締役 副社長

志方 哲明

取締役

光崎 尚利

取締役

高橋 政典

取締役

森本 孝貴

社外取締役

石田 智也

社外取締役

富田 和之

執行役員

酒井 信治

執行役員

岩木 正夫

執行役員

山中 毅

執行役員

大野 和彦

常勤監査役

長田 和幸

社外監査役

越本 幸彦

弁護士

社外監査役

古谷 礼理

公認会計士

2026年6月末現在

経営理念

「未来品質の創造」

社会を支えて、未来に残す。

assists your thinking

考えて 考えて 考えぬく

お困りごとを
解決

for smiles of the future

社会貢献になる仕事

製品の安心・安全を
支える

コア・コンピタンス

assists your "thinking"

Qualtec

Quality + technology

品質

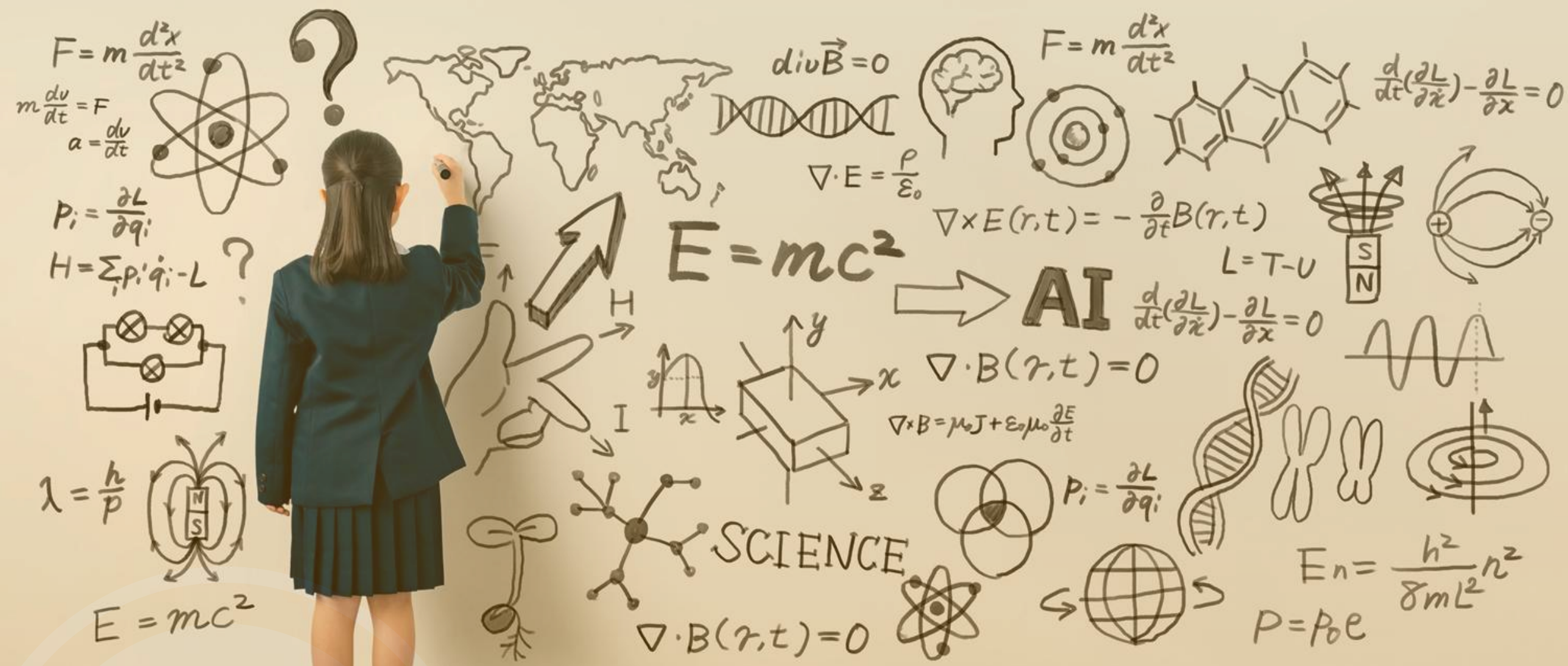
技術

当社のコア・コンピタンスは「品質技術サービス」にあります。

お客様にお届けするこのサービスは、

「信頼性評価事業」「微細加工事業」「その他事業」という3つの柱と、

「研究開発部門」が支えています。



02 | 事業概要

ありたい姿

中立性 + 透明性 + 信頼性を合わせ持つ

創造型技術集団

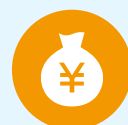
分析・信頼性試験・パワーサイクル試験・レーザ加工・表面処理・研究開発等のトータル技術を活かし、半導体を中心とした先端分野に挑戦する、未来企業を目指します



- ・幅広い学術領域をカバーする専門家集団
- ・設計や製造の現場に精通した技術者集団



- ・110種700台以上の評価・分析設備
- ・190種以上の試験メニュー保有



- ・盤石な財務内容と着実な成長体質



- ・自動車・半導体・家電業界における幅広い顧客基盤
- ・大学や専門機関、協力企業との連携



ISO/IEC17025

東証上場

・製品の生命線となるキーアイテムに対する信頼性評価の重要性の増大

・技術の進化に伴うアウトソース需要の増加

顧客基盤



外部環境

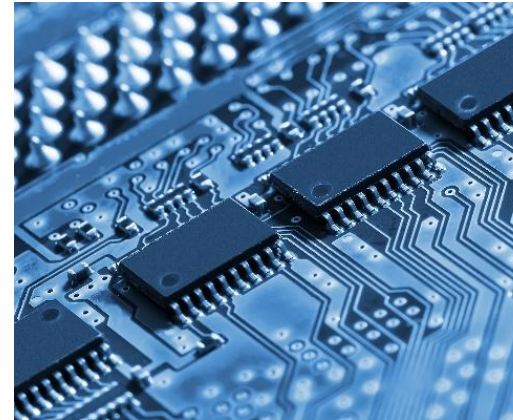
産業構造の大転換



電動化



脱炭素



半導体開発の
加速



先進医療推進

“高度かつ高信頼”な評価・解析需要が拡大

製品開発サイクルの高速化により、外部パートナーへの依存度が増加

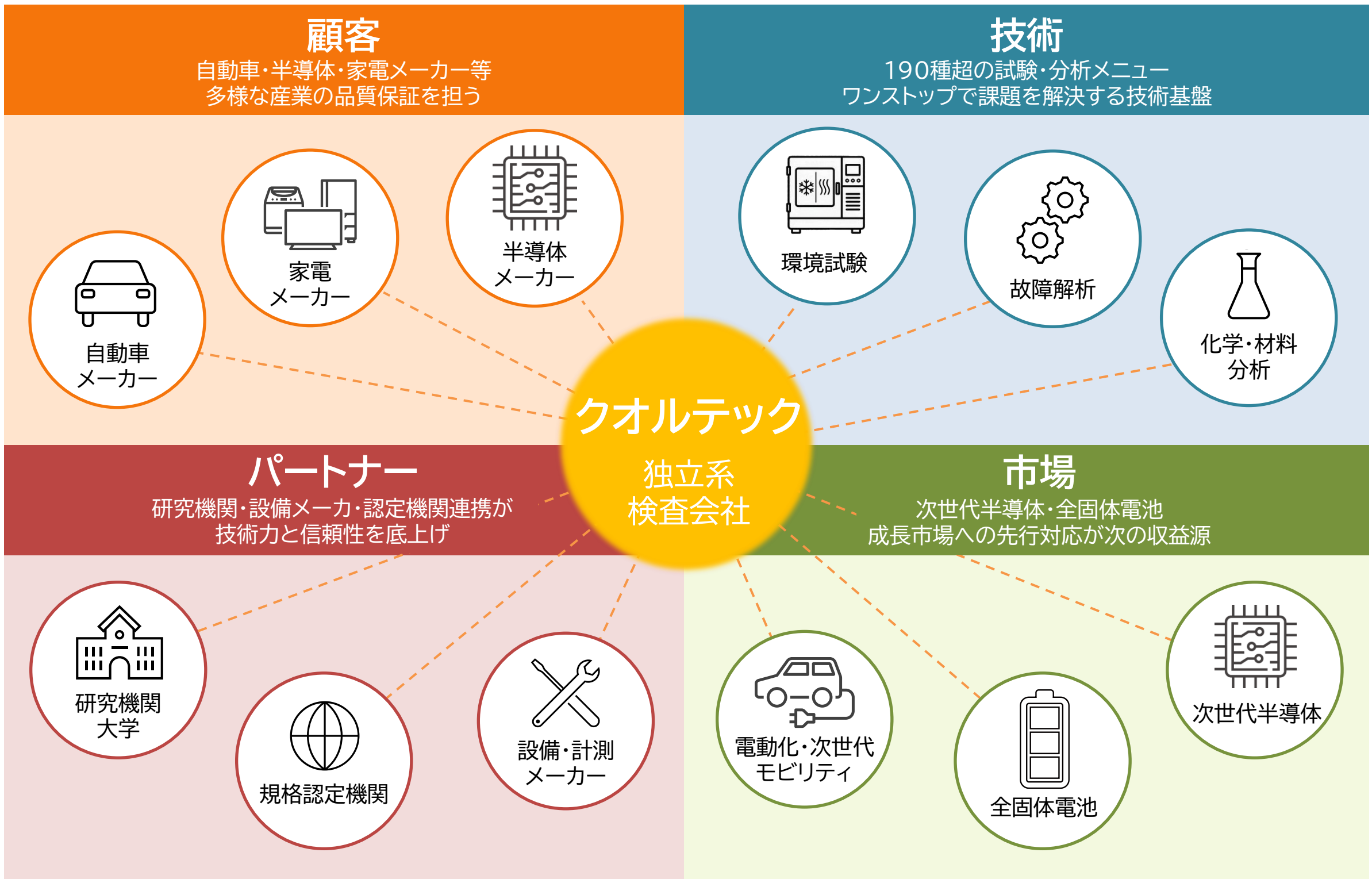
分析・評価のリーディングカンパニーである当社への需要は、今後さらに加速

ポジショニングマップ(戦略価値)

戦略価値

- | | | | |
|---|--|------------------------------------|---|
| 1 |  次世代技術対応力
電動化・半導体シフトの波に乗る
先行投資で次の10年の収益基盤を構築 | 先端半導体・全固体電池・
MAPプロジェクトの事業化 |  技術障壁 |
| 2 |  独立系上場会社
親会社を持たない中立性が
競合他社には模倣できない信頼の源泉 | 自動車業界・半導体業界から
高い信頼 |  信頼障壁 |
| 3 |  ワンストップソリューション
顧客の切り替えコストが高く
リピート率・長期契約の基盤となる | 分析→故障解析→信頼性試験→
微細加工→研究開発を単社完結 |  統合障壁 |
| 4 |  多分野専門家集団
育成に5～10年を要する高度人材の
集積は短期間では不可能 | 物理・化学・電気工学・生化学を
網羅するスペシャリスト |  人的障壁 |
| 5 |  試験インフラ基盤
最新の設備群と試験所認定取得
→新規参入を実質的に阻む | 110種・700台以上の試験設備
ISO/IEC17025取得 |  参入障壁 |

ポジショニングマップ(顧客・市場)



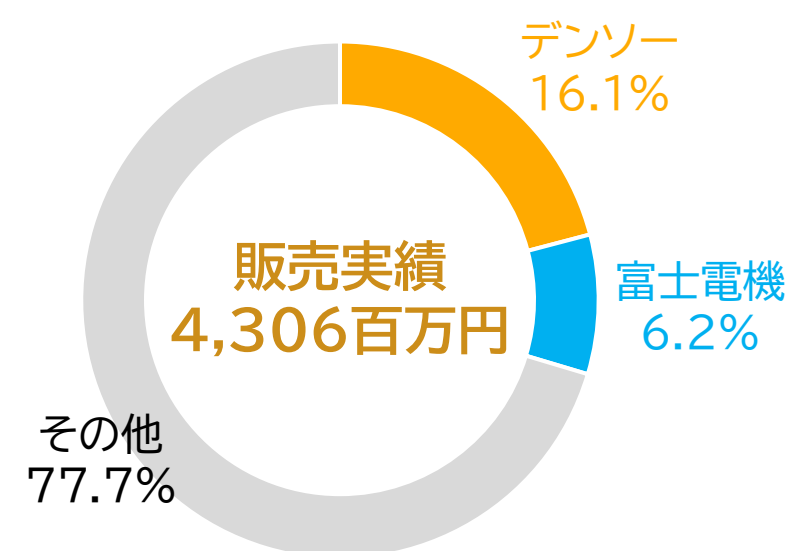
当社の顧客基盤

自動車・半導体業界の大手企業が当社のお客様。中でも、CASE（Connected、Autonomous、Shared/Service、Electricの略）や先端半導体などモビリティの変革をけん引する株式会社デンソー様は当社の主要顧客。

当社の主なお客様

アイシン、味の素、Astemo、大阪ガス、オムロン、キオクシア、京セラ、クボタ、GSユアサ、シマノ、シャープ、住友電装、ソニー、大丸興業、大昌電子、デンソー、デンソーテン、東芝、トヨタ自動車、豊田通商、日産自動車、日本オーチス・エレベータ、日本シイエムケイ、日本電気、任天堂、パナソニックグループ、富士電機、富士フイルム、ホシデン、堀場製作所、本田技研工業、マレリ、三菱重工業、三菱電機、村田製作所、安川電機、矢崎部品、ヤンマー、Rapidus、利昌工業、レゾナック、ローム（五十音順 敬称略）

販売先の構成

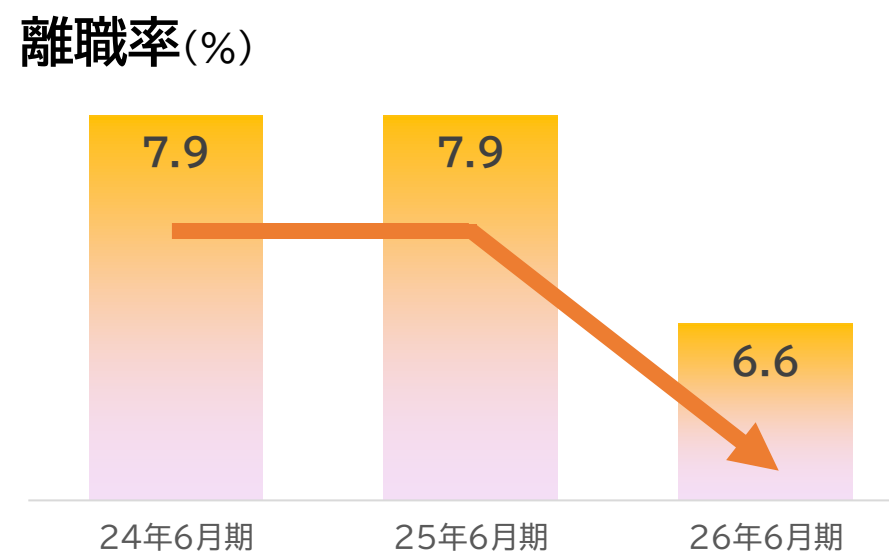
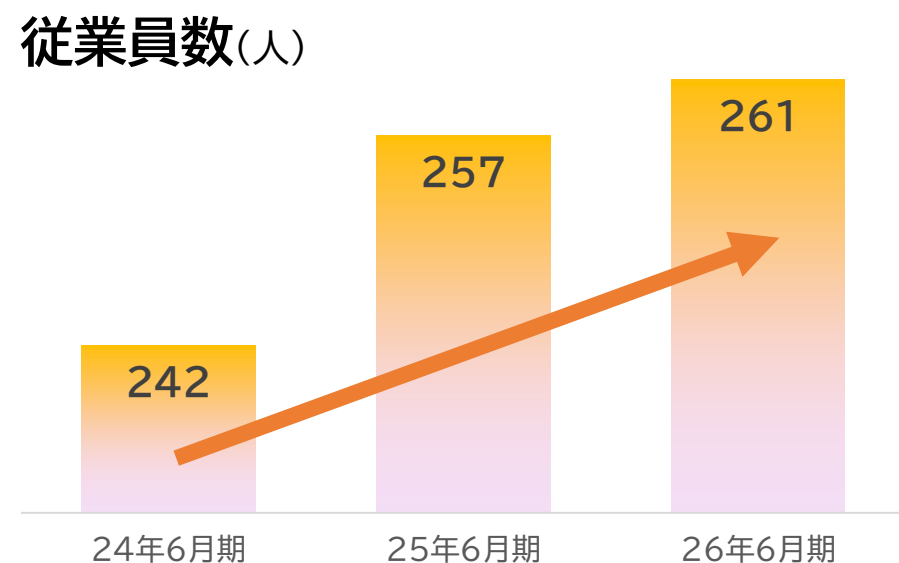
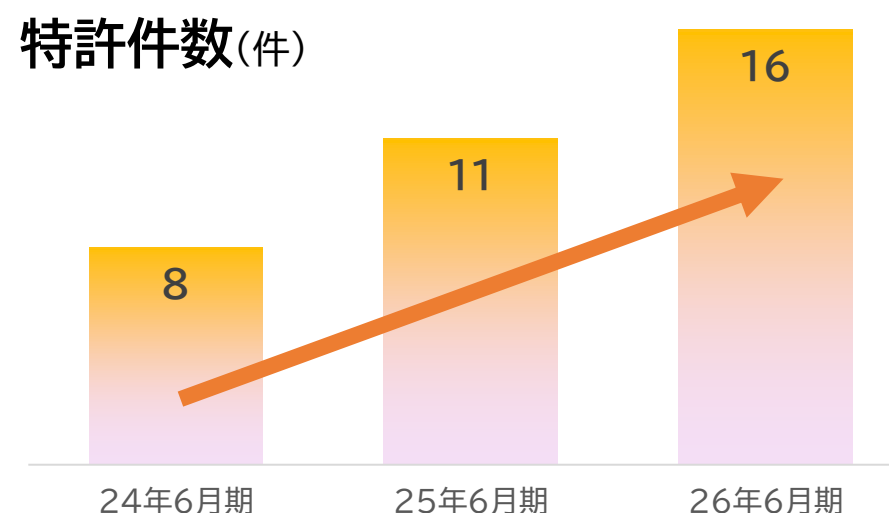
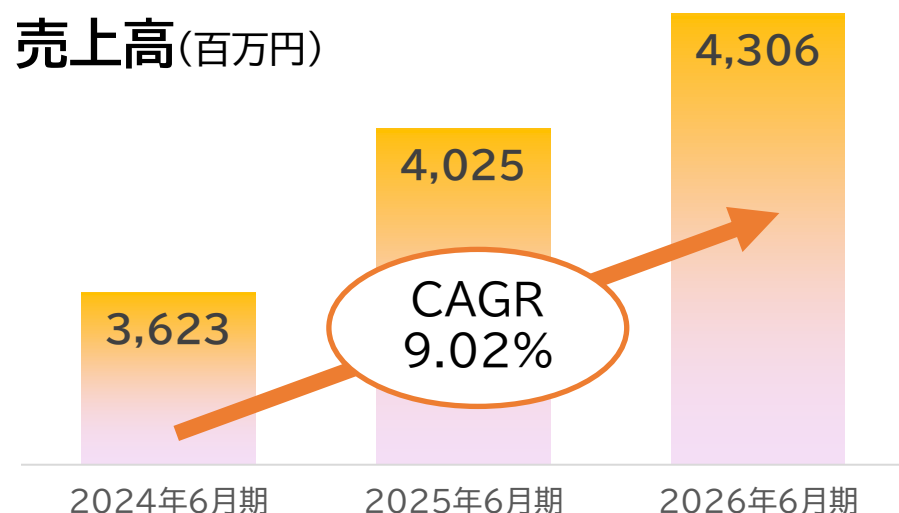


※構成比率は2026年6月期

成長の実績

成長の軌跡は、信頼の積み重ね。

人員も、設備も、技術も——私たちは、お客様の声に真摯に向き合いながら、売上高・装置数・特許数・従業員数の拡大とともに着実な成長を遂げてきました。

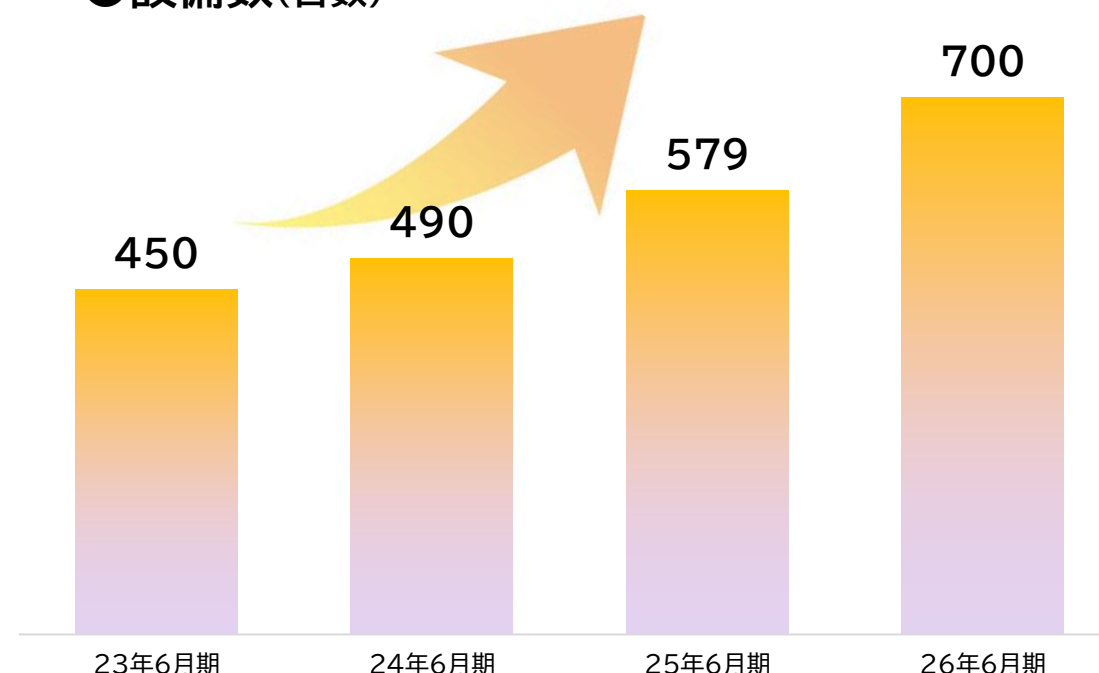
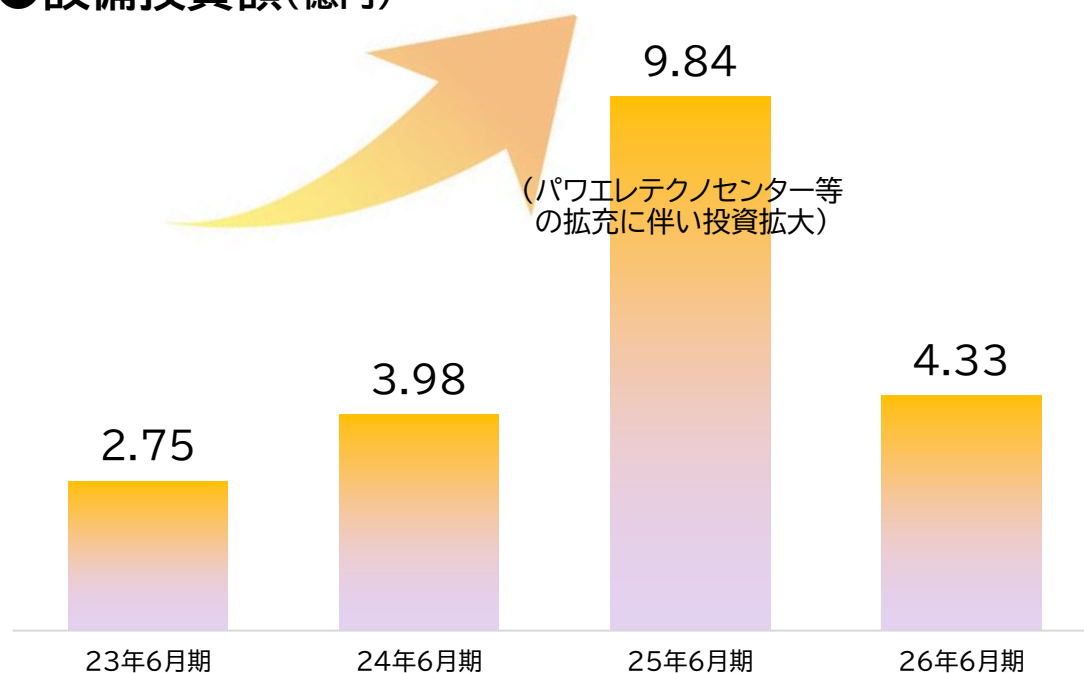


積極的な設備投資によるノウハウの蓄積

高度な分析には、性能の良い装置や設備が不可欠となり、以前から設備投資を実施。最先端の設備をはじめ、**110種以上、700台以上の設備**を保有。

●設備投資額(億円)

●設備数(台数)



分析・故障解析機器の一例



X線CT装置

ロックイン発熱解析装置

信頼性試験機器の一例



冷熱衝撃装置

大型複合振動試験機

レーザ加工機器の一例



フェムト秒
グリーンレーザ加工機

キャリアと若さを両立した人的財産

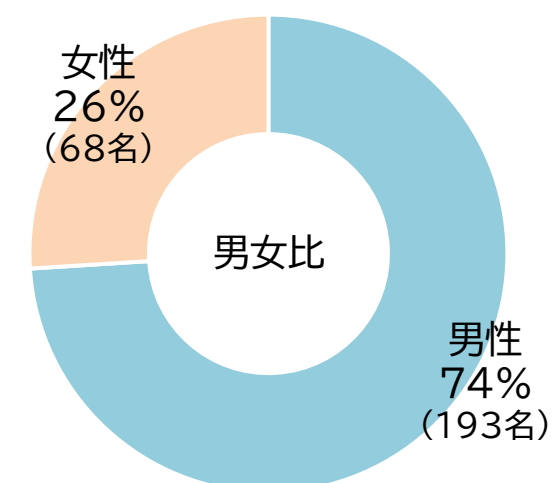
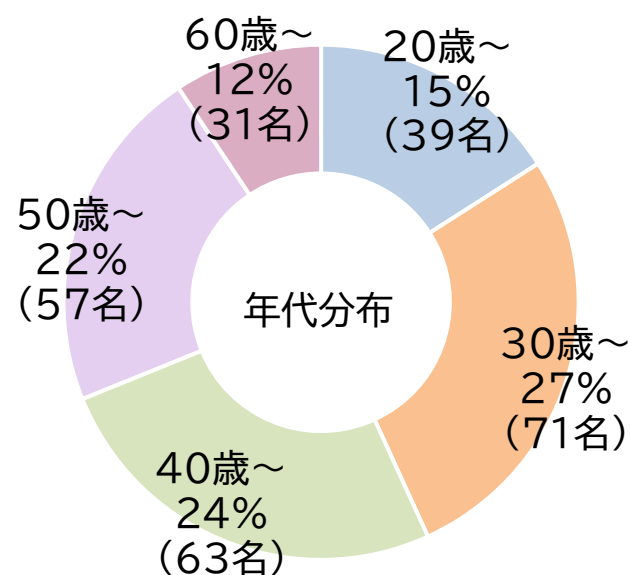
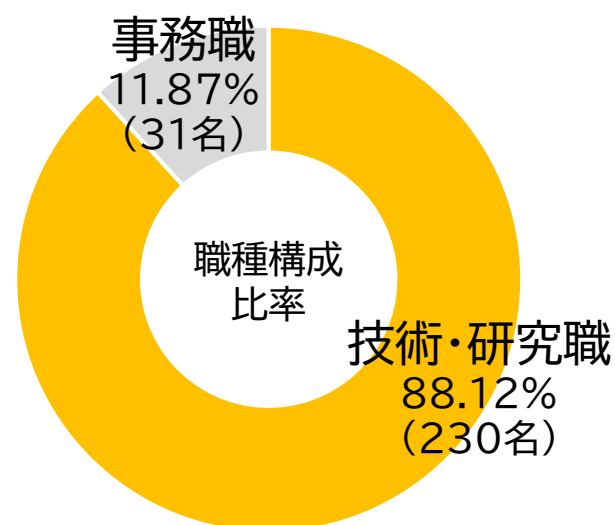
技術・研究職230名が支える技術。

20～30代の若手にキャリア豊富なベテランが技術継承を行い、技術力・分析力を日々錬磨しています。



社員数 261名

2026年6月末現在

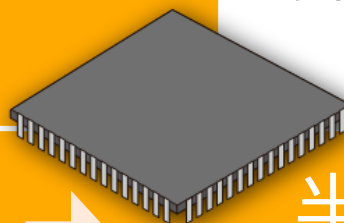


信頼性評価事業における提供サービス

ワンストップで対応
約190種
幅広い試験メニュー

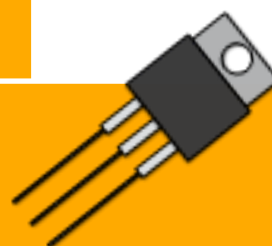
多種・多様な試験・分析が存在しますが、当社は技術力が高く、多くの試験・分析に対応可能です。当社のお客様であるメーカーサイドは、複数の試験をアウトソースするため、同一の会社で多くの試験を完結させられることを喜んでいただけるケースが多いです。

環境試験
分析・故障解析



半導体・電子部品・プリント基板・
PCU・新素材(合金・プラスチック)他

パワーサイクル試験
※1



パワー半導体・電子部品
※2

断面研磨

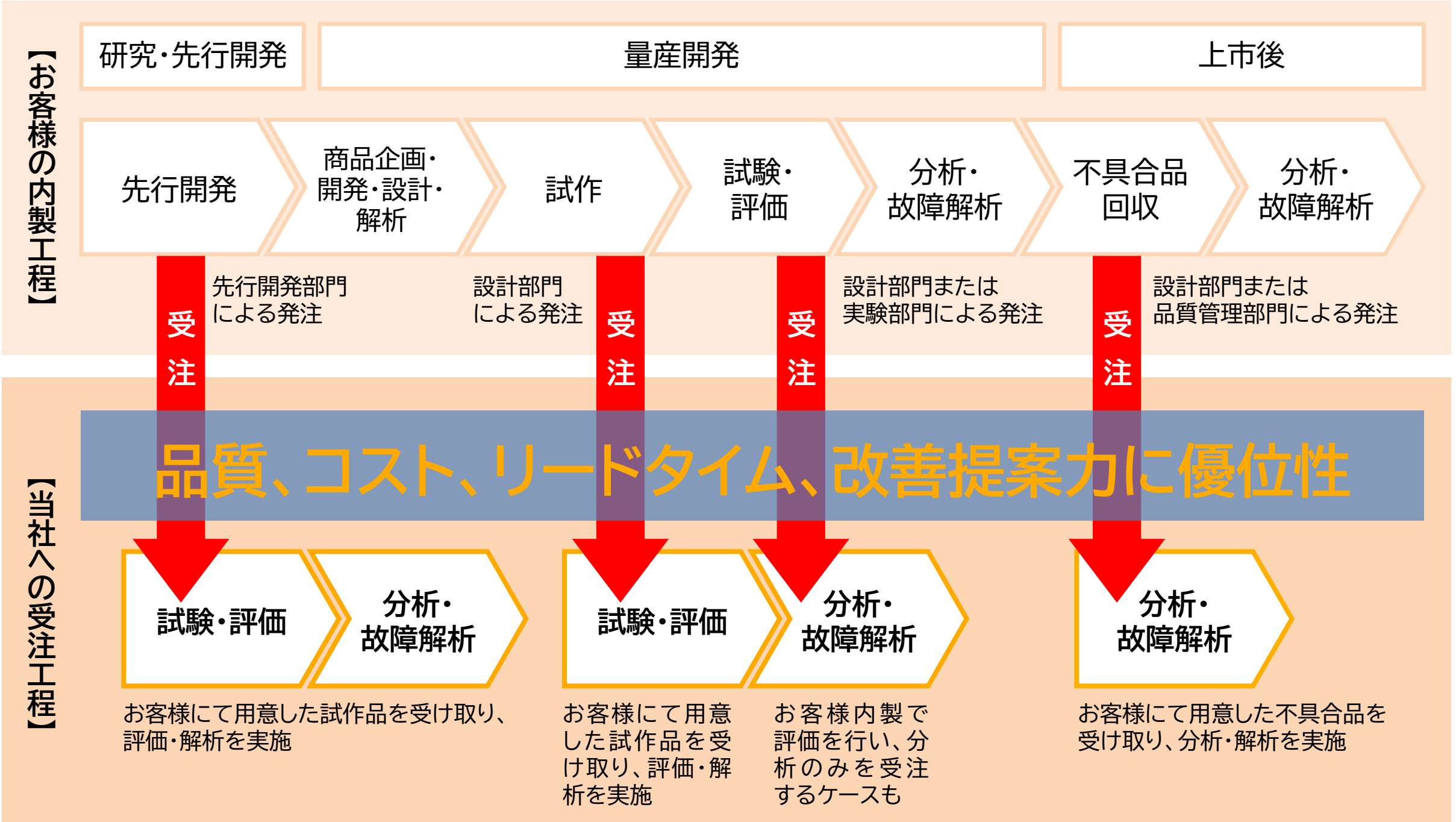


上記素材の切断と研磨加工

※1 パワーサイクル試験: パワー半導体モジュールに使用される各部材の接合信頼性を評価するための機器。
※2 パワー半導体: 高電圧や大電流を取り扱うことができる半導体。

信頼性評価事業における顧客工程と当社受注について

顧客の先行開発から上市後まで**ワンストップでカバー**。先行開発から受注した案件は、量産開発や上市後も合わせて受注するケースが多く、**スイッチングコストが高い**状況。



微細加工事業における提供サービス

【レーザ加工】

20年以上の実績
24時間受付
22台保有

基板のレーザ加工はもちろん、短納期の試作品加工からビッグロットの量産加工まで受注しています。CO2レーザ加工、UV-YAGレーザ加工、フェムト秒グリーンレーザ加工により、特殊な材料の加工、工法が可能。



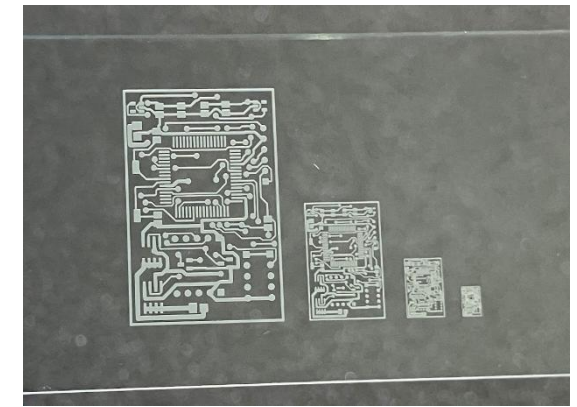
CO2レーザ加工機



UV-YAGレーザ加工機



フェムト秒グリーンレーザ加工機



ガラスへの試作加工

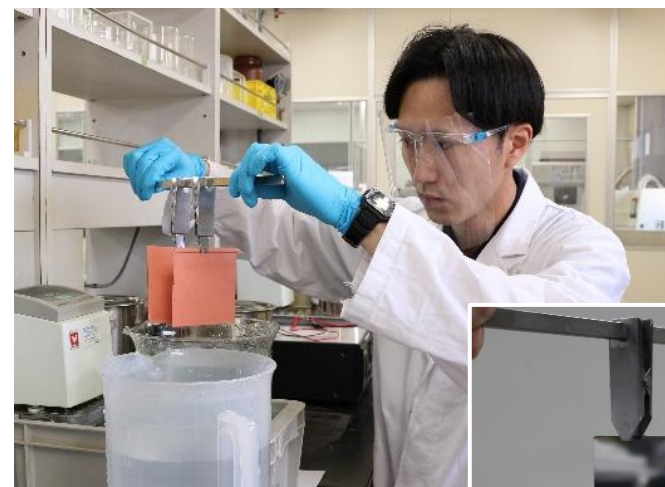
受注加工／ビルドアップ基板、フレキシブル基板、シリコンウェハ、セラミック基板、他

微細加工事業における提供サービス

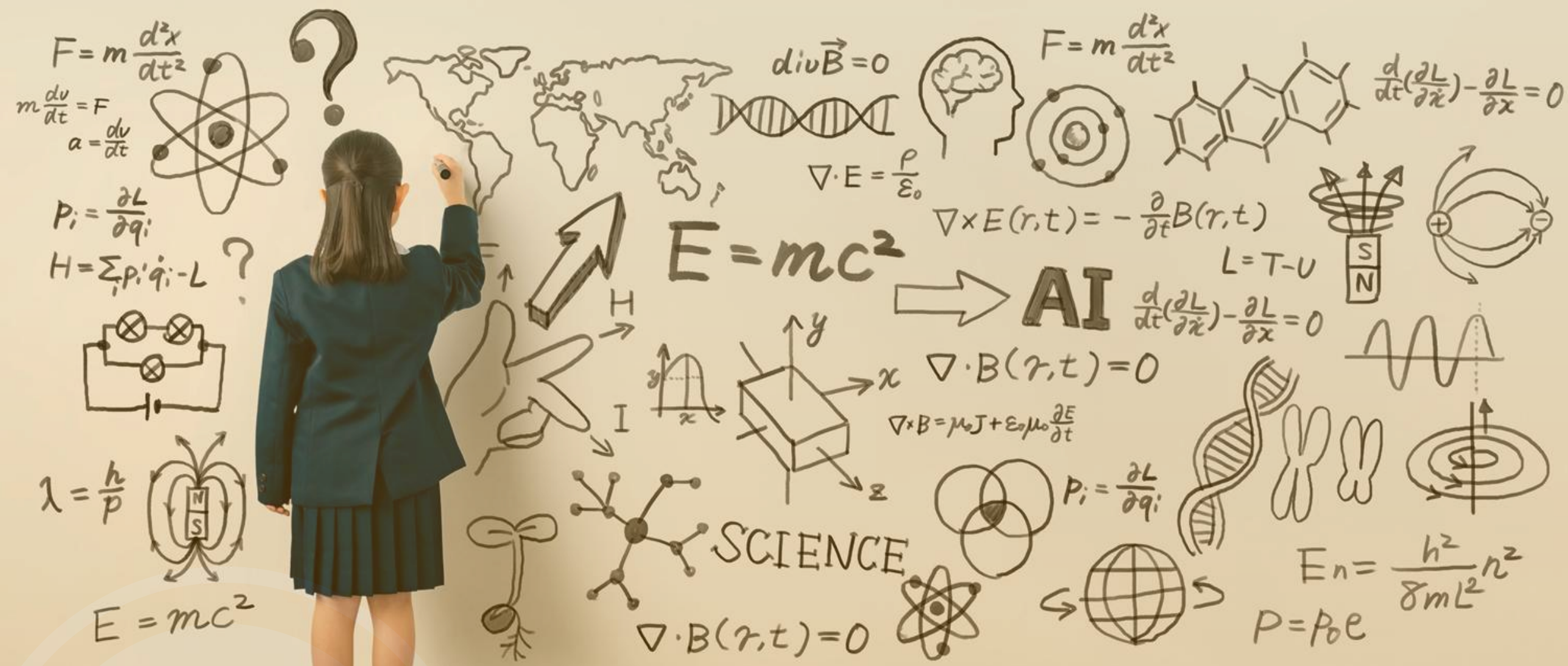
【表面処理】

試作加工
素材の機能化
応用分野の開拓

試作から量産化への移行を想定した条件設定を行い、開発期間の短縮に貢献します。ウェットプロセスによるめっき処理については数多くの実績を持ち、素材の機能化や新たな応用分野開拓に力を注いでいます。また、当社独自の表面処理技術開発にも取り組んでおります。

スピード
対応小ロット
対応

受注処理／デスミア処理、めっき処理、耐薬品性試験・薬液処理、他



03 | 成長戦略

当社の成長可能性概略

永年培った信頼性評価技術の安定成長を基盤に、事業領域を拡大し、高付加価値、成長市場を中心とした利益成長により、企業価値を高めます。

① 事業ポートフォリオと成長戦略



	安定収益基盤	高付加価値	成長市場	新しい事業の柱	未来創造
事業内容	信頼性評価事業	信頼性評価事業 (分析・解析部門)	微細加工事業 (レーザ加工)	パワー半導体 評価装置	新規事業 (MAPプロジェクト)
特徴	安定成長	高単価	量産	既存事業の拡充	新規技術
重点 マーケット	自動車、家電、 電子部品	半導体 ファウンドリ	医療機器 データセンター	車載、電機 メーカー	半導体、基板、ガラス、 金属加工など広範
強み	顧客基盤・設備	設備・技術者	設備・技術者	蓄積した試験データ	環境配慮、低コスト
戦略	営業強化によるシェア アップ、設備投資	設備投資、人材育成、 営業強化	設備投資、営業強化に よる案件獲得	パワエレクト活用、人材獲得	立命館大学共同研究、 用途開拓



② 投資計画

投資戦略

設備投資:2027年6月期 9億円予定など前倒しに実施
2030年までに大阪、名古屋の拠点増設予定(九州、北海道も検討)
事業提携、M&Aも機会を捉えて機動的に実施



③ 目標

KPI

2027年 売上46億円／営業利益5億円
2030年 売上70億円／営業利益10億円／当期純利益7億円

政策「17分野」と当社の位置づけ

コア技術のクロスオーバーからシナジーを生む“基盤技術企業”

日本政府戦略17分野から選定した「4ターゲット」

AI・半導体

品質／信頼性の
外部基盤

航空・宇宙

部品レベルの
信頼性試験・故障解析資源・エネルギー
安全保障パワー半導体など部品の
熱・通電・サイクル耐性

創薬・先端医療

医療機器用センサの
レーザ加工

【コア技術】

【信頼性評価事業】

信頼性試験・分析・故障解析・断面研磨

【微細加工事業】

レーザ加工・表面処理

【研究開発】表面処理・実装・人工知能・二次電池・研磨

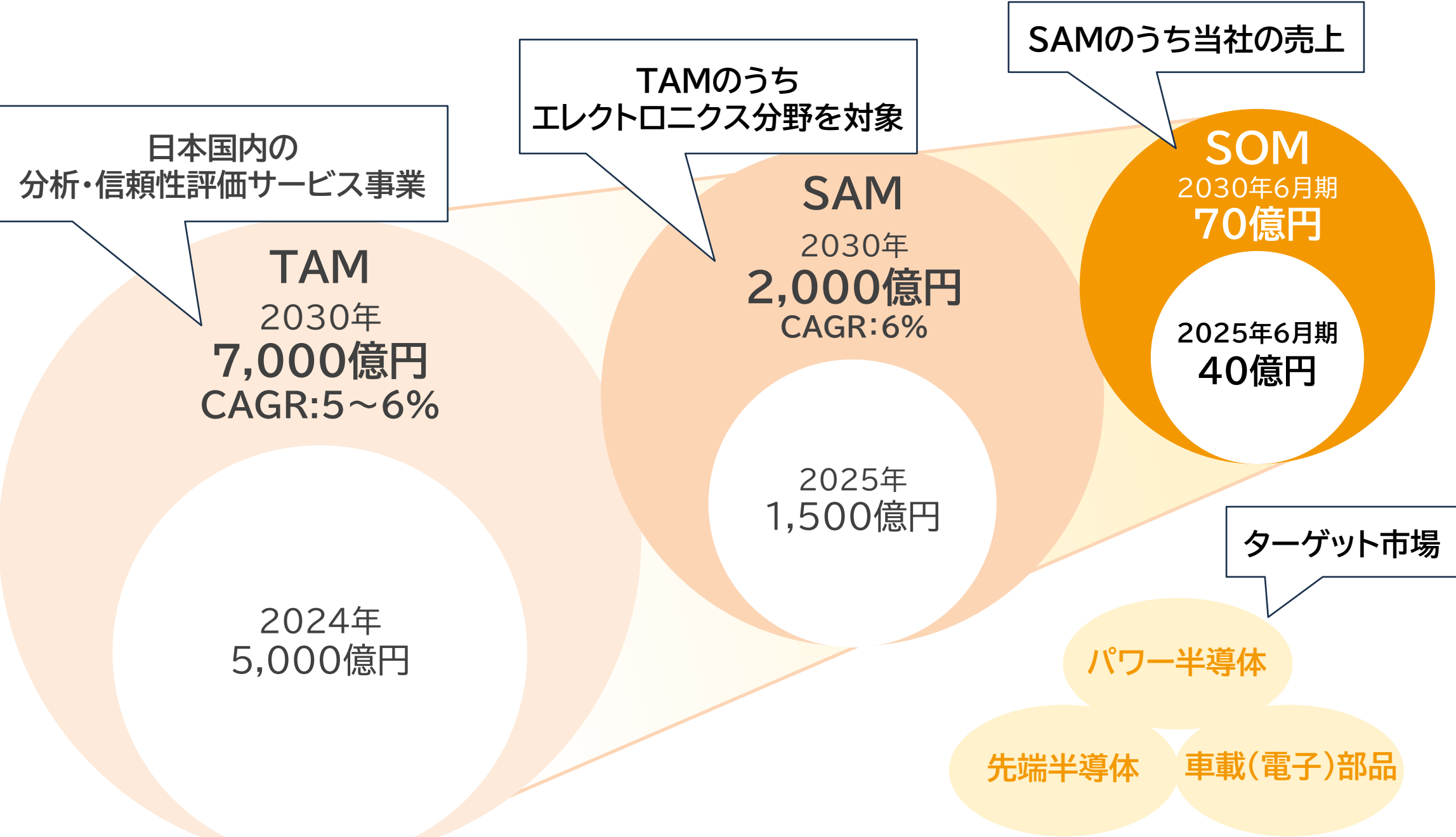
【ファンクション】

能増投資(新拠点含む) + 最新機種 of 積極導入 + 人財の確保 + 操業度の向上

信頼性評価事業について

信頼性評価事業の市場見通し

国内分析・信頼性評価サービス事業の外注市場は、2030年7,000億円と推定。エレクトロニクス分野を対象とした外注市場規模は、試験業務増大&外注率増加により、2030年2,000億円に増大予測。



信頼性評価事業について

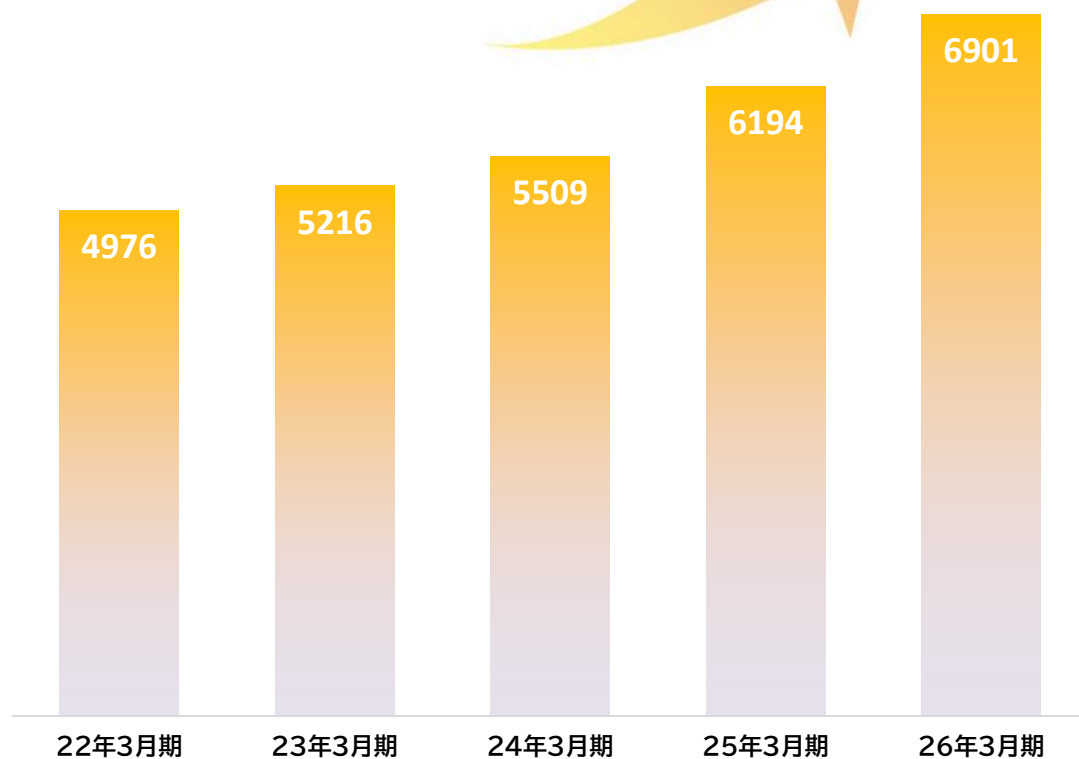
信頼性評価事業の主要顧客の動向

主要顧客の研究開発費動向について、デンソーは電動化・知能化領域を中心に今後5年間で3.7兆円の研究開発費を投入する方針。富士電機は今後3か年累計で1,300億円規模の研究開発費を計画。

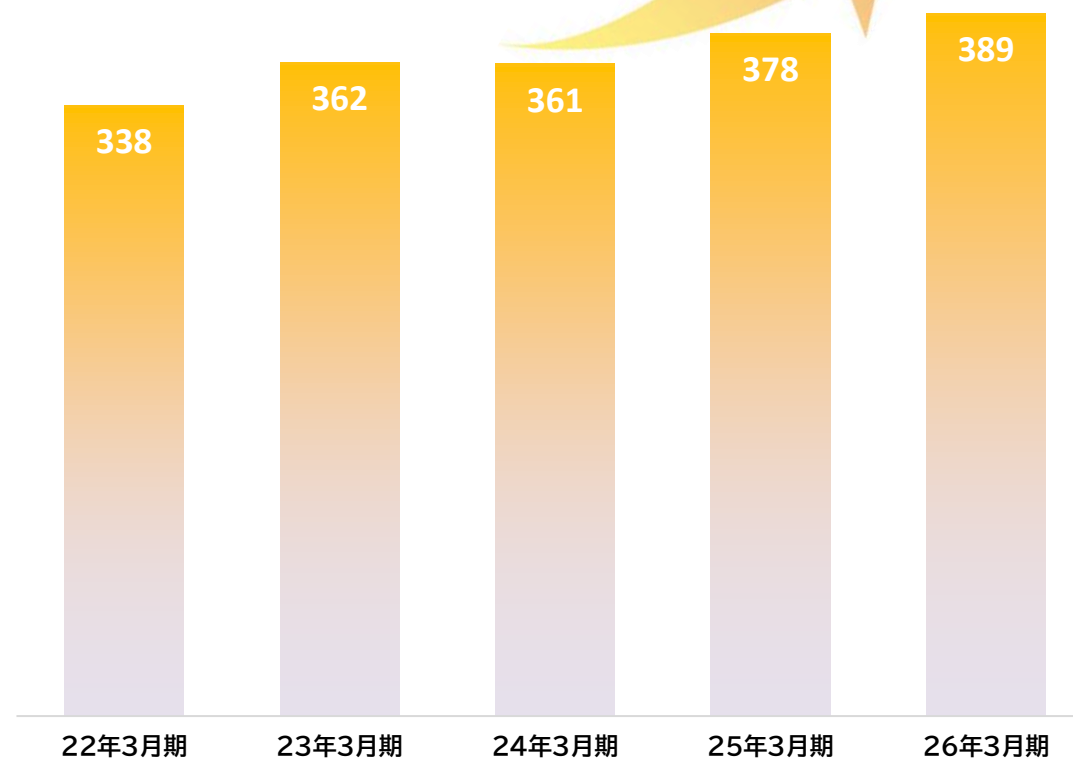
主要顧客の研究開発費推移

デンソー研究開発費(億円)

富士電機研究開発費(億円)



出所:デンソー有価証券報告書より



出所:富士電機有価証券報告書より

信頼性評価事業について

信頼性評価事業成長のマイルストーン

裾野の広い市場を背景に、 事業拡大を実現します

進化のプロセス

- ▶ 組織構造改革
- ▶ 積極投資(設備・人財)、拠点拡充
- ▶ AI活用
- ▶ パワー半導体 評価装置事業の拡大

再構築フェーズ：
設備・組織の
基盤拡充

収穫フェーズ：
新拠点の
開設・拡充

加速フェーズ：
装置事業への
本格進出
(新規事業領域の確立)

AI活用サービスと
新規事業の現実化

フェーズが進むごとに
ストック性が高まる

2026年(現在)

2027年

2028年

2029年

2030年(目標)

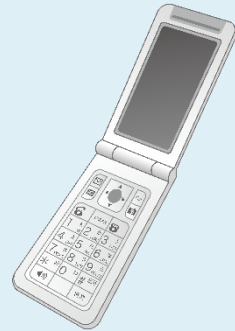
微細加工事業について

微細加工事業の継続的成長

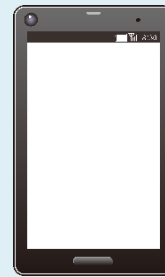
パイロットラインを基にモノづくりをしながら、レーザ加工を実施してきました。



電子機器等
マザーボード加工



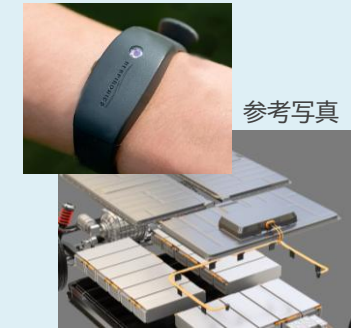
携帯電話等
フレキ基板の加工



スマートフォン等
ディスプレイ基板加工



通信機器等
パッケージ基板加工



医療系・車載系
パッケージ基板加工

UV-YAG/CO2



UV-YAG



UV-YAG/CO2



UV-YAG/CO2



グリーンフェルト秒

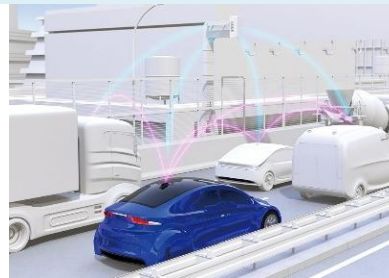


微細加工事業について

微細加工事業の継続的成長

当社の微細加工事業の現在の注力市場は、①車載部品 ②ヘルスケア ③通信その他。
今後も各市場の拡大が予測され、当社への受注増が見込まれる。

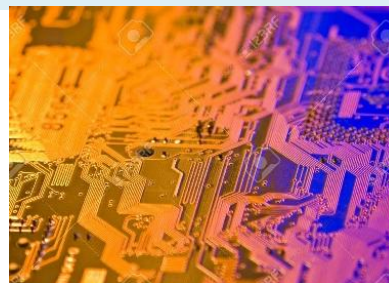
①自動運転に関連したカメラモジュール、ミリ波レーダ、照明用LED放熱基板などの車載部品



②医療機器、医療器具等のディスプレイパネル品、超音波プローブ、カテーテル、マイクロ流路



③高周波基板、大電流基板、バスバー内蔵基板などの特殊プリント配線板

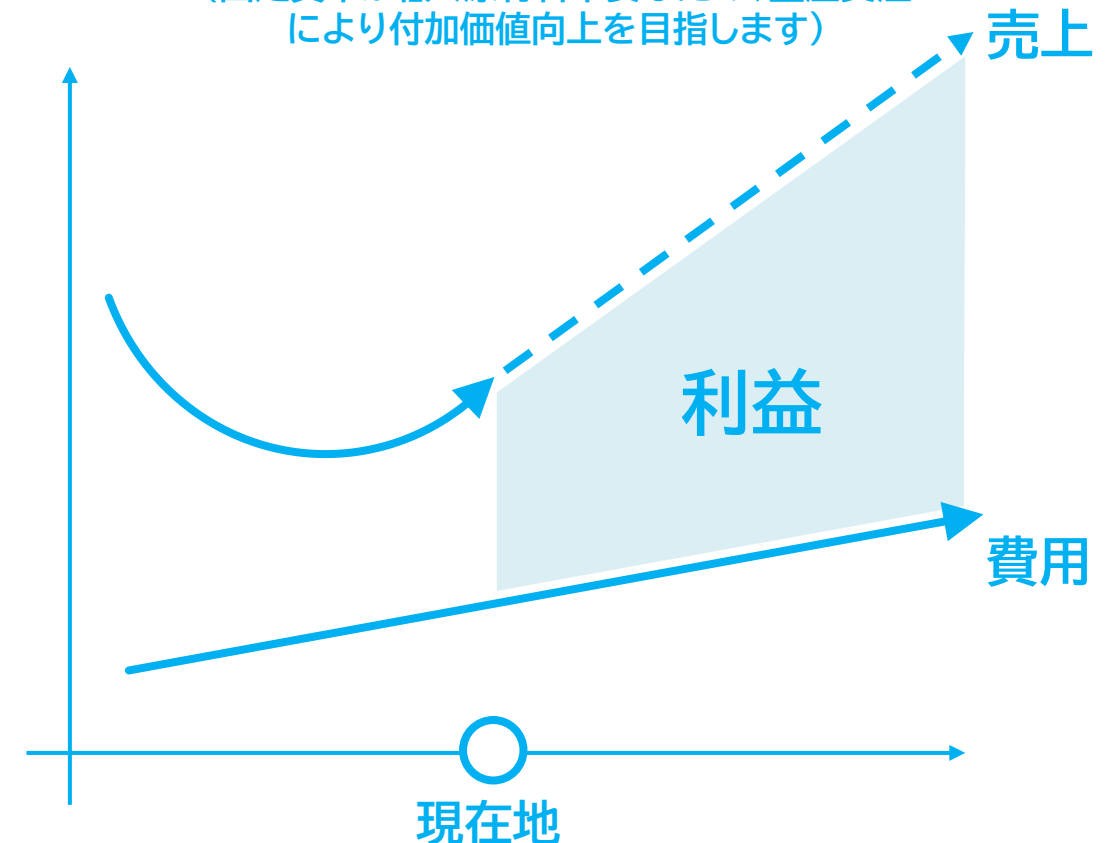


オペレータ × 設備 × レーザ
= 高難度ものづくり

高付加価値・特殊用途・
製品ライフの長い製品
の受注を目指す

レーザ加工事業の収益構造イメージ

(固定費率が低く原材料不要なため、量産受注により付加価値向上を目指します)



資本配分の基本方針

通常の事業運営に必要な投資とは別に、2030年までに将来の成長機会に迅速に対応するための戦略投資枠を30億円と想定しています。

総額30億円の戦略投資枠と各用途の取扱方針について

保有キャッシュ
(手許運転資金外)の活用
10億円

+

資金調達
15億円

+

営業キャッシュフローのうち
戦略投資への利用
5億円



① 成長投資

試験・解析・加工能力の拡張、
大阪・愛知・九州・北海道等での新拠点設置

信頼性評価事業 需要拡大の確度が高まった段階で、新拠点の開設・拡充を含む成長投資を検討。

微細加工事業 事業機会の解像度が高まった段階で、10億円以上の成長投資を検討。



② M&A

隣接領域への展開、技術・人材の獲得によるアライアンス強化

2026年6月期は小規模同業者からの事業譲渡を成約。常時、事業シナジーや成長機会が認められる案件について情報収集中。専門家と連携を取りつつ、機会を逃さず機動的に投資を実行する方針。



③ 株主還元

配当水準の維持・向上

2026年6月期においては、大幅増益の現況を踏まえ、1株当たり配当を37円から47円に引上げ。今後も利益水準や投資計画を考慮しつつ、適正な水準で推移させる方針。



④ 財務健全性

健全な投資判断による取り組み
金融機関の信用維持・向上

設備投資に対しては、社内審査においてCF回収期間5年の計画が見込まれるものに投資。永年の健全経営による財務健全性から金融機関の調達余力を有しており、更に信頼を得られる投資に使用する方針。

新規事業について

3つの軸で新たなフィールドに挑戦

評価装置メーカーへの進化

受託試験から試験機販売まで、総合的なソリューションを提供

豊富な
受託評価
の知見次世代
パワー半導体の
社会実装に
伴う、新たな
技術課題パワー半導体試験機関連
特許登録件数
・国内(日本)
16件
・国際(米国、中国)
2件パワー半導体試験機
の開発・製造・販売
での強みを発揮

AIのフル活用による経営進化

- ・電子部品実装部の画像解析ソフトの開発・販売
- ・X線CT×AI解析による3D・非破壊解析サービス
- ・フィジカルAIによる標準化・24時間稼働化
- ・AIナレッジマネジメントシステム
- ・人事評価制度の改革



先端半導体パッケージに向けた新技術の開発

- ・MAPプロジェクト(ユニバーサルめっき法) → P.36～38参照
- ・先端半導体用ガラスコア基板へのめっき技術
- ・先端半導体パッケージに適した分析・信頼性評価技術
- ・電子部品実装部の信頼性寿命予測シミュレーション

産学連携:MAPプロジェクト①

早期
事業化

MAPプロジェクト

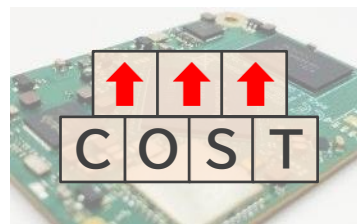
【Mist-Assisted universal Plating Project】

本プロジェクトでは、貴金属価格の高騰や国際的な環境規制への対応といった課題を背景に安定供給可能な低コストかつ環境配慮型技術として、「ユニバーサルめっきによる新たなコーティング技術」の確立を目指す研究開発を進めてまいります。

背景 お客様のお困りごと

・原料コストや装置コストの上昇

例) 貴金属の急騰、
輸入コストの上昇、
物価の上昇



・環境規制の厳格化

例) RoHS指令、
REACH規制、
PFAS規制



解決できる手段・方法

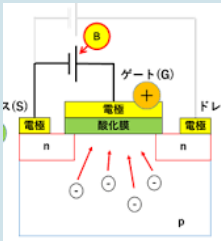
次世代成長産業を支える**低コスト**かつ
安定供給可能な**環境配慮型技術**の確立

ユニバーサルめっき法による
コーティング技術の開発

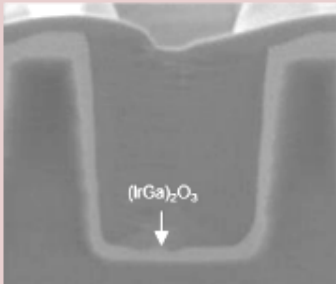
産学連携:MAPプロジェクト②

ユニバーサルめっきを用いた機能性膜のコーティング例

機能性膜…基材の表面に付着することで、基材に新たな機能を与える

膜材料	ITO, IGZO	HfO ₂ , Y ₂ O ₃	Al ₂ O ₃ , Ti, Ru	SnO ₂ , TiO ₂
				
機能	導電性	絶縁性	耐摩耗性	耐薬品/耐酸化

×

基材	絶縁体	管の内壁	繊維上	微細構造
				

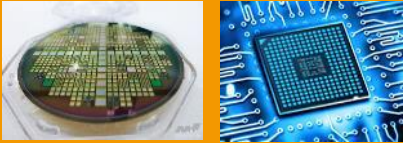
次世代成長産業の発展へ大きく寄与できる可能性あり

通信



スマートフォン/
基地局

半導体



パワー半導体/
パッケージング

医療



CT,X線/
インプラント

航空宇宙



タービン/
宇宙船窓

再エネ



水素発電/燃料電池
ペロブスカイト
太陽電池

産学連携:MAPプロジェクト③

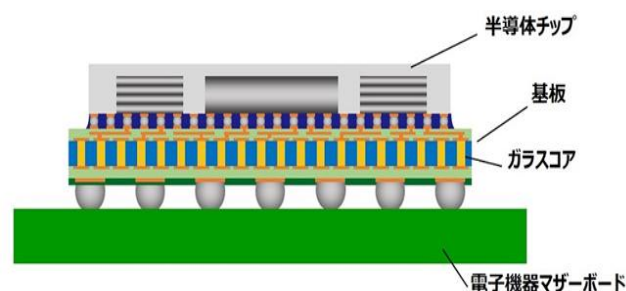
◆ 研究内容について

従来のめっきプロセスで利用されている銅、ニッケル、クロム等の金属をガラス、樹脂、セラミック等の絶縁体上に成膜し、膜の特性や密着性の評価を行います。また、白金等の貴金属製品の代替として、安価な基材の表面に貴金属をコーティングした製品の開発を行います。

◆ 補助金について

(令和8年度成長型中小企業等研究開発支援事業(GoTECH補助金))

「低環境負荷のユニバーサルめっきを用いた次世代半導体用
ガラスコア基板の実用化開発」



・次世代の半導体パッケージに利用されるガラスコア基板やインターポーザ基板への応用

(令和7年度滋賀県プロジェクト補助金対象事業)

「ユニバーサルめっきによる
貴金属コーティング膜の密着技術開発」



- ・高温、高腐食環境下における部材耐久性の向上
- ・半導体結晶成長用るつぼ、結晶成長炉の内部部材への適用
- ・高温熱処理炉の内部部材、原料リチャージ部材への適用

◆ 開発体制について

研究開発は立命館大学総合科学技術研究機構と共同で進めてまいります。開発を加速させるため、2025年9月に立命館大学びわこ・くさつキャンパス テクノコンプレクス産学連携ラボラトリーに研究開発拠点を開所しました。



成膜実験、評価、装置開発
製品開発、販路開拓、特許出願



材料開発、メカニズム解明



滋賀半導体研究開発センター
(分析・評価)

立命館大学BKCテクノコンプレクス
産学連携ラボ(研究開発)

研究開発の強化

新規事業のシーズ開発と既存事業の成長支援を目的にした研究開発を行っており、積極的な特許取得を含め多彩な技術を軸とした研究により、新たな事業分野を創出。

目的	内容	当社事業への貢献
新規事業の シーズ開発	はんだ等実装部のクラック進展予測シミュレーション	信頼性試験期間の短縮
	MAPプロジェクト	環境負荷低減技術
	亜鉛二次電池/フッ化物イオン電池の材料評価技術の研究	安全な次世代二次電池
	測定業務の自動化を利用した非破壊技術による 製品寿命予測の研究	循環型社会への貢献
事業化促進	X線/AIを活用したボイド・クラック画像解析アプリ	観察・測定業務の自動化
	電池材料のインピーダンス測定	電池解析の技術拡張
	パワー半導体試験装置の開発/製造	装置事業への進出
	マイグレーションを中心に研究の受託を拡大	受託研究の拡大
既存事業の 成長支援	断面研磨および断面検品の自動化	研磨作業の省力化
	スラリー/研磨用バフおよび小型研磨機の自社開発	研磨の効率化とコストダウン
	めっきによる電池負極の性能向上	表面処理の応用性向上

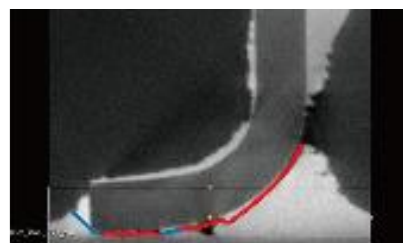
2026年6月期 【登録特許】16件 【学会発表(依頼講演、外部セミナー含む)】18件

事業化推進：X線/AIを活用したボイド・クラック画像解析アプリ

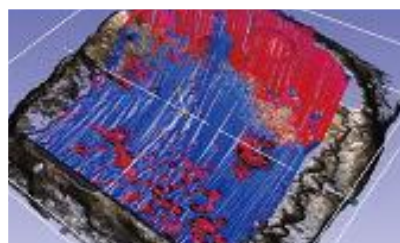
AIを活用した、はんだクラックの3D非破壊解析とX線のボイド検査技術

■X線CTの画像データとAIの画像検査により、はんだの「真の姿」を解明。

例1)リード部品 はんだ部



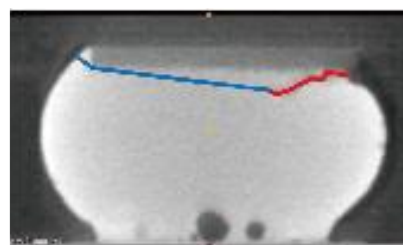
従来 (クラック率)



本手法 (3Dクラック率)

クラック率:
16.6%~60.0%
▼
3Dクラック率:
36.2%

例2)BGA はんだ部



従来 (クラック率)



本手法 (3Dクラック率)

世界初！
特許出願中！

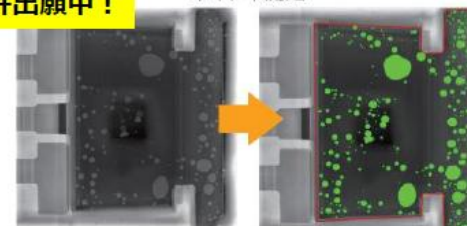
クラック率:
0%~29.4%
▼
3Dクラック率:
7.7%

赤部:クラック部
青部:予測部

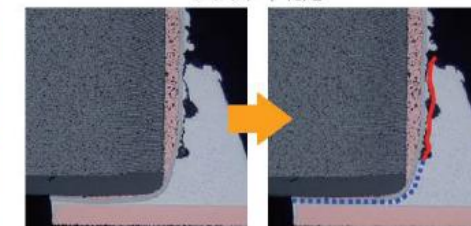
■クオルテックのAI画像検査プラットフォーム「Qualap」

特許出願中！

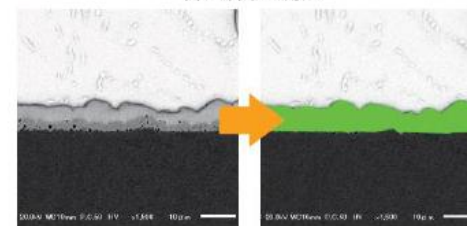
ボイド率測定



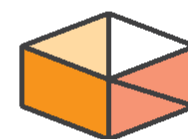
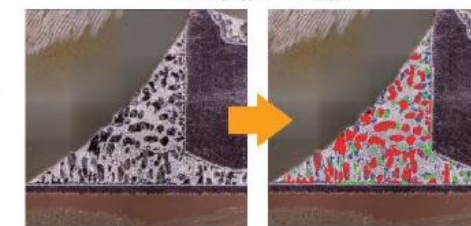
クラック率判定



合金層厚さ測定



はんだ組織サイズ測定



Qualap

詳しくはWebサイトでも
<https://qualap.jp>

◆ 事業の特徴と当社の優位性

- ①従来の手動解析が抱える「不便さ」と「不正確さ」を解消
- ②当社が最も知見を持つ業界を初期ターゲットに設定
- ③高度な独自AI技術による自動化と高精度化を実現
- ④研究開発で蓄積したビッグデータとの親和性

◆ 期待される新規事業

本解析技術の一般化、性能向上により、多くの新規事業の可能性につながります。現在は、自動車関連を中心に多数の研究や試験依頼を受けており、資源循環を目的とした非破壊技術の向上等、社会問題の貢献に寄与します。

◆実績

AIクラック試験受託 72件(26/6期)
ボイド解析ソフト販売 37ライセンス(20-26/6期)

◆特許 登録特許:4件(登録番号:7262782,
7497086, 7728536, 7754486)

◆受賞歴:

- ・第51回信頼性・保全性・安全性シンポジウム:奨励報文賞
- ・第28回エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術:萌芽研究賞
- ・人工知能学会全国大会(第39回):優秀賞

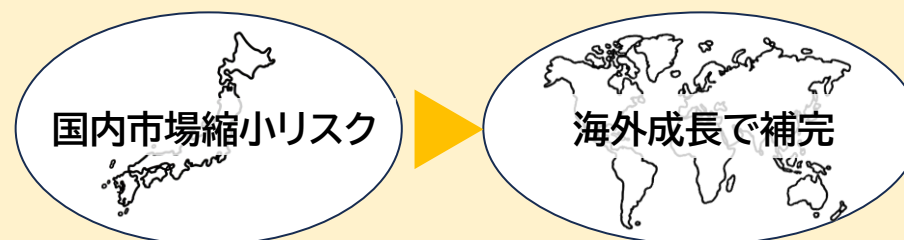
販売強化

グローバル展開と国内拠点網の拡充



グローバル化の布石

国内市場の縮小リスクに備え、海外での成長により補完する



アジア圏での
拠点構築を検討
成長市場への足がかりを確保



ラボの新拠点・営業拠点を検討

事業拠点

東京

愛知

大阪

滋賀

+

新拠点

信頼性・微細加工の拡張予定に合わせて検討

営業拠点

東京

愛知

大阪

熊本

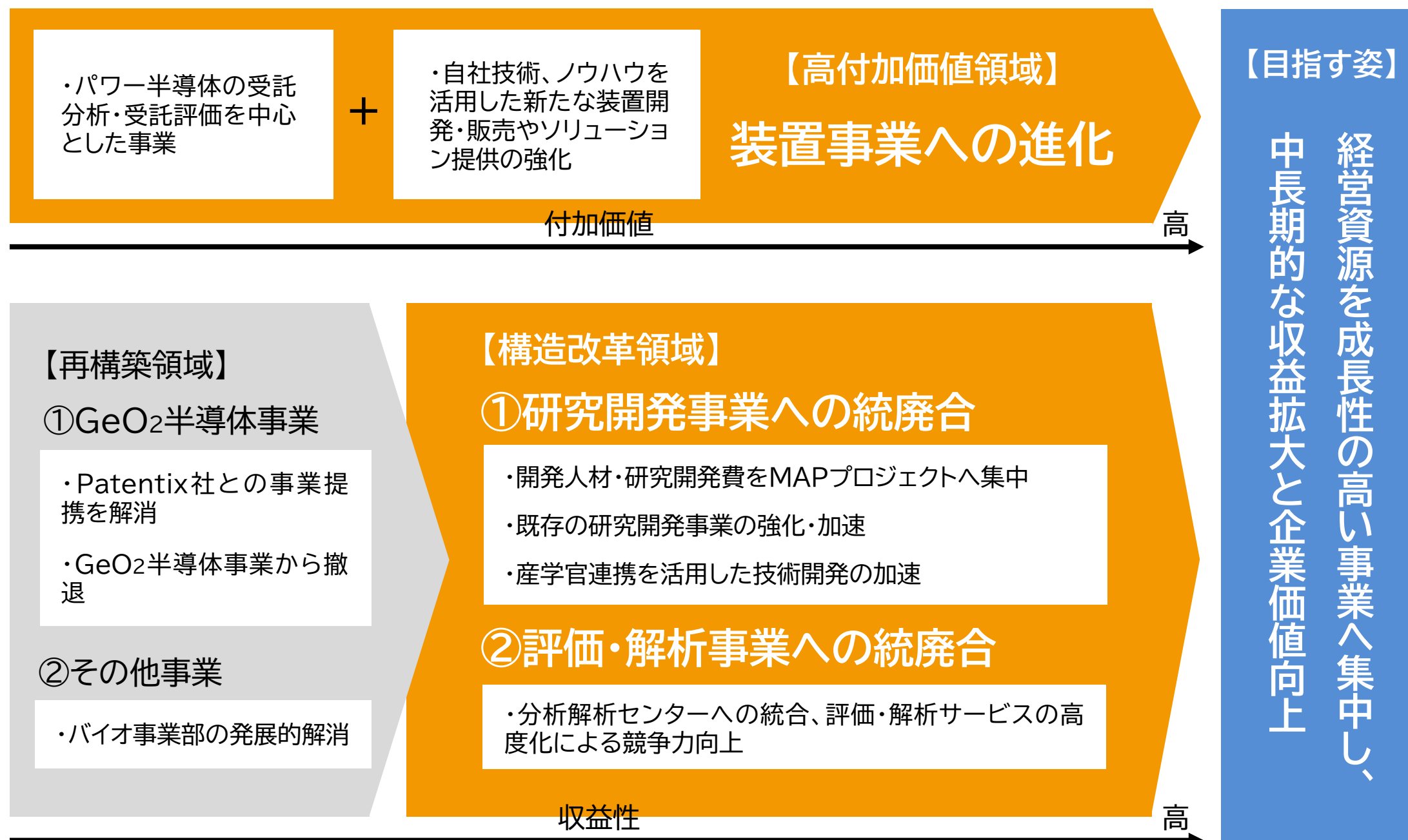
+

新拠点

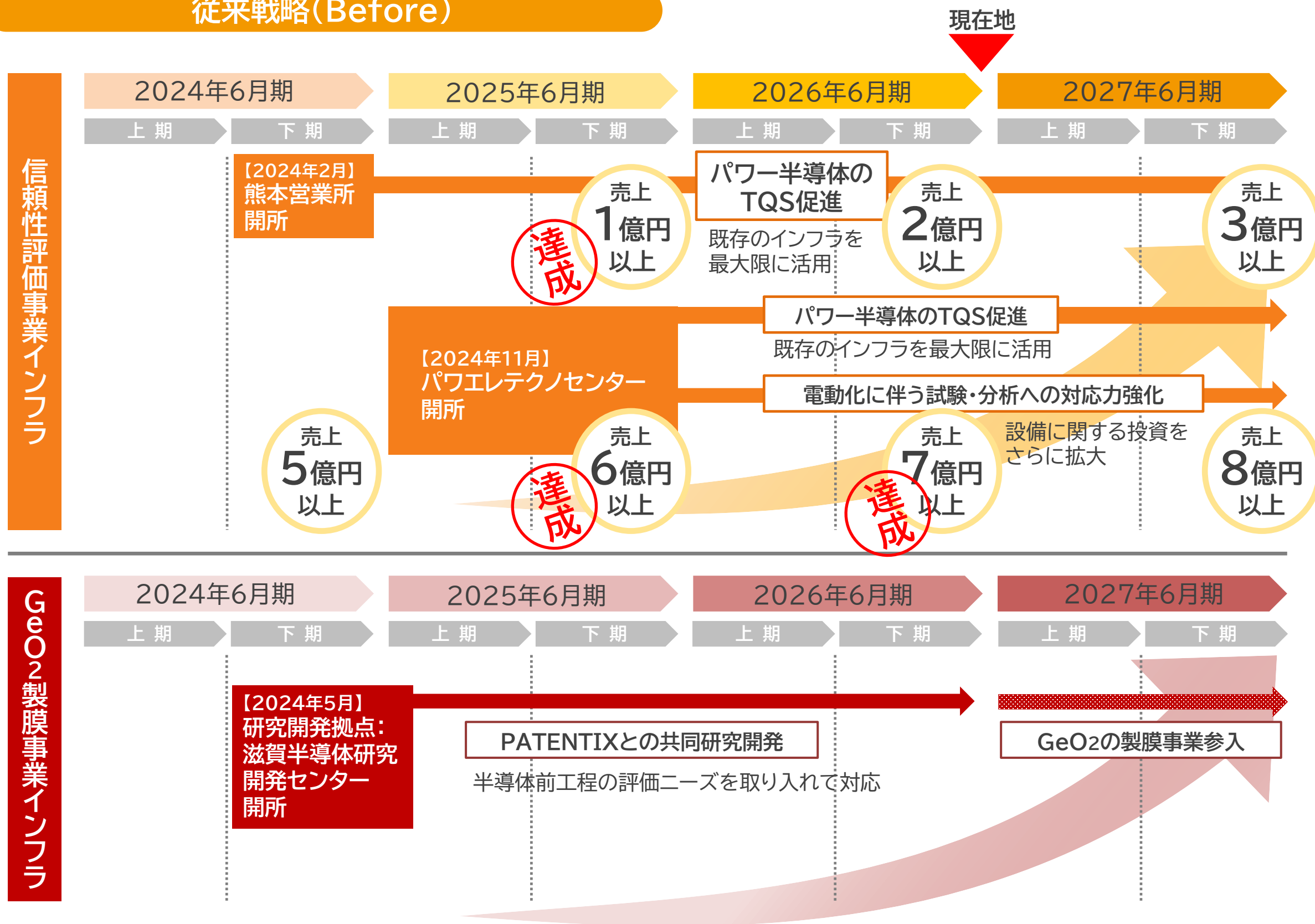
新規顧客・新規市場へアプローチしやすい立地で検討

事業ポートフォリオの見直し

半導体事業において「パワー半導体の受託事業から装置事業への進化」と「GeO₂半導体およびバイオ事業からの撤退およびMAPプロジェクト・既存研究開発事業へのリソース集中」を軸に事業ポートフォリオの見直しを図ります。

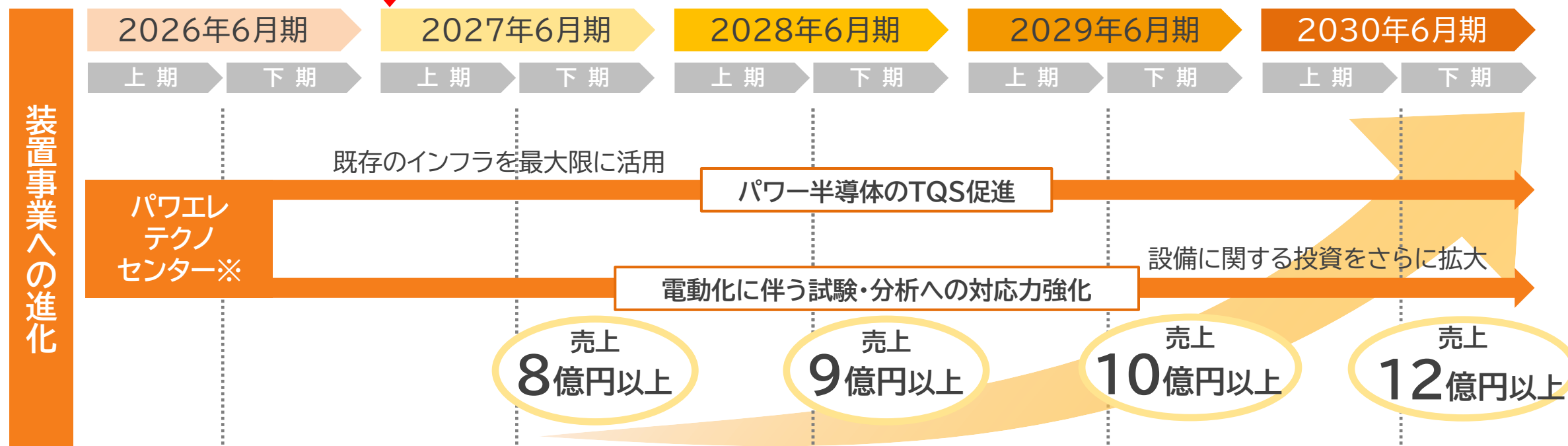


従来戦略(Before)

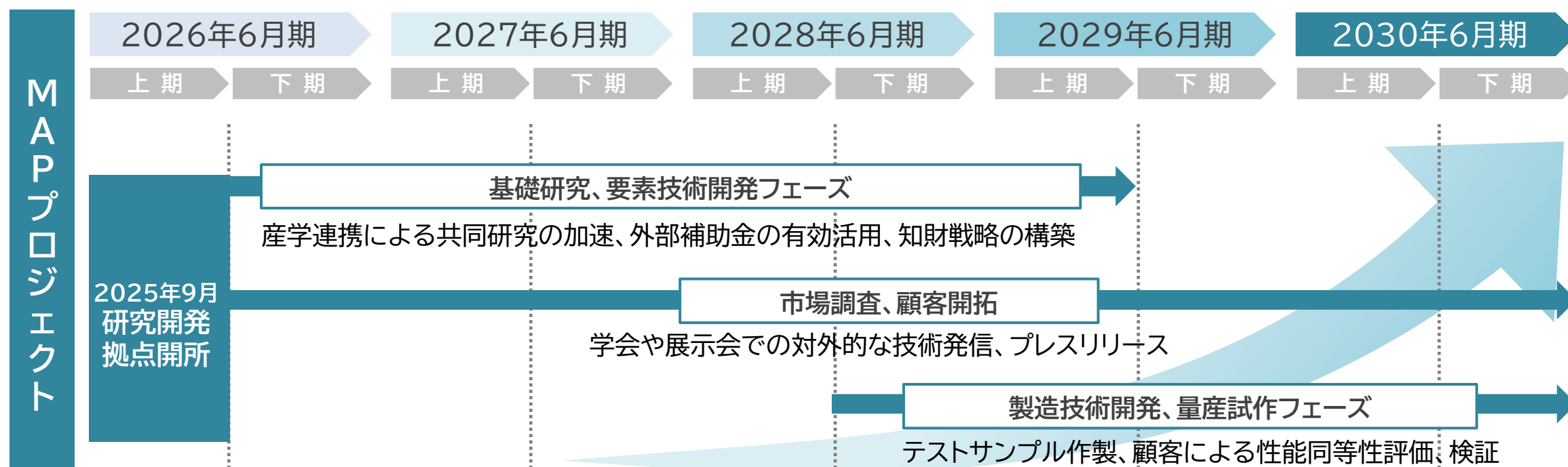


新戦略(After)

現在地



※当社パワエレ評価センター合計



04 | 業績見通し

事業の全体像

信頼性評価事業

売上構成比

87.1%

営業利益率

32.4%

微細加工事業

売上構成比

12.3%

営業利益率

51.5%

その他事業

売上構成比

0.6%

営業利益率

—

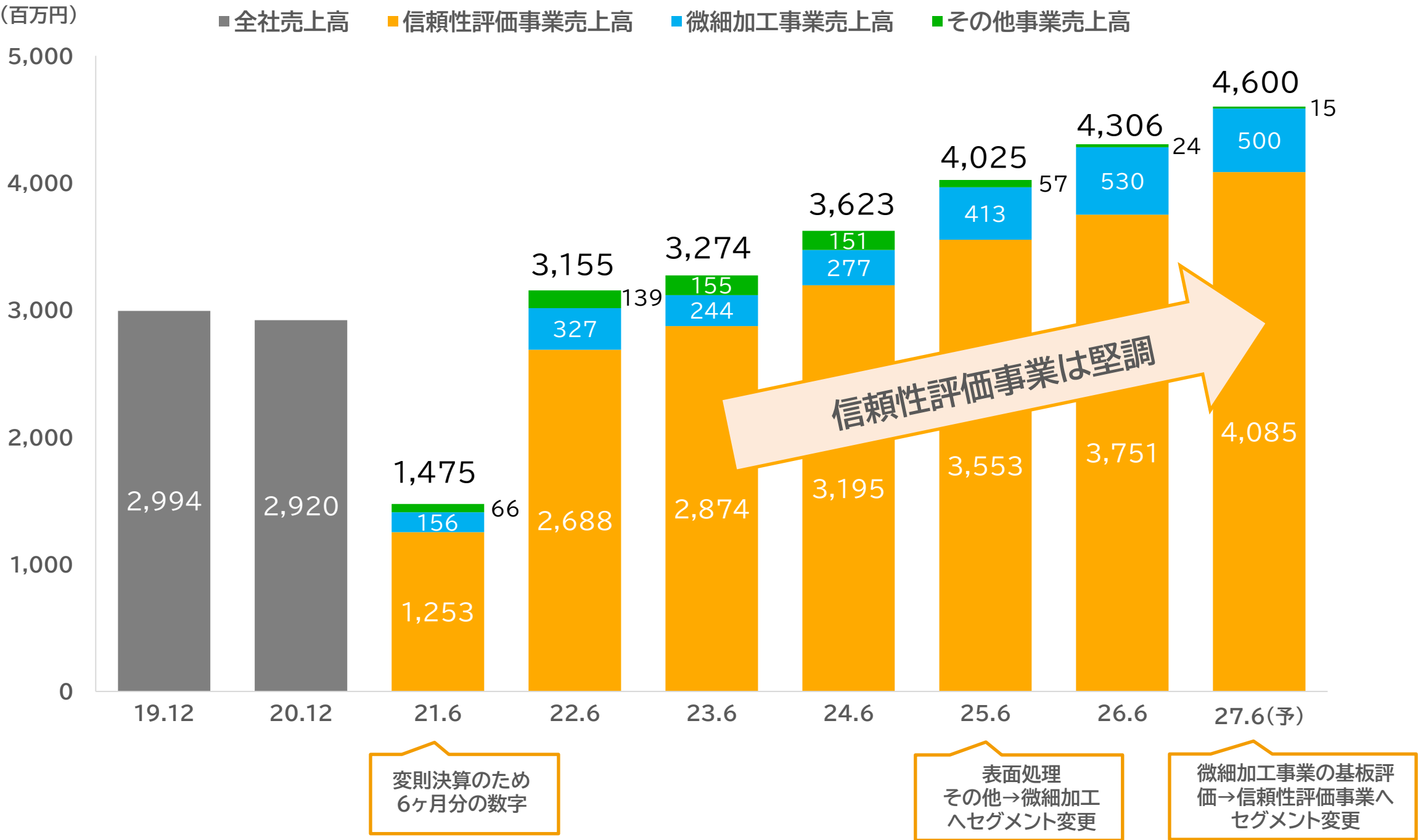
研究開発部門

全社営業利益率 11.4%

売上構成比・営業利益率は共に2026年6月期実績(セグメント情報は本社共通費除く)

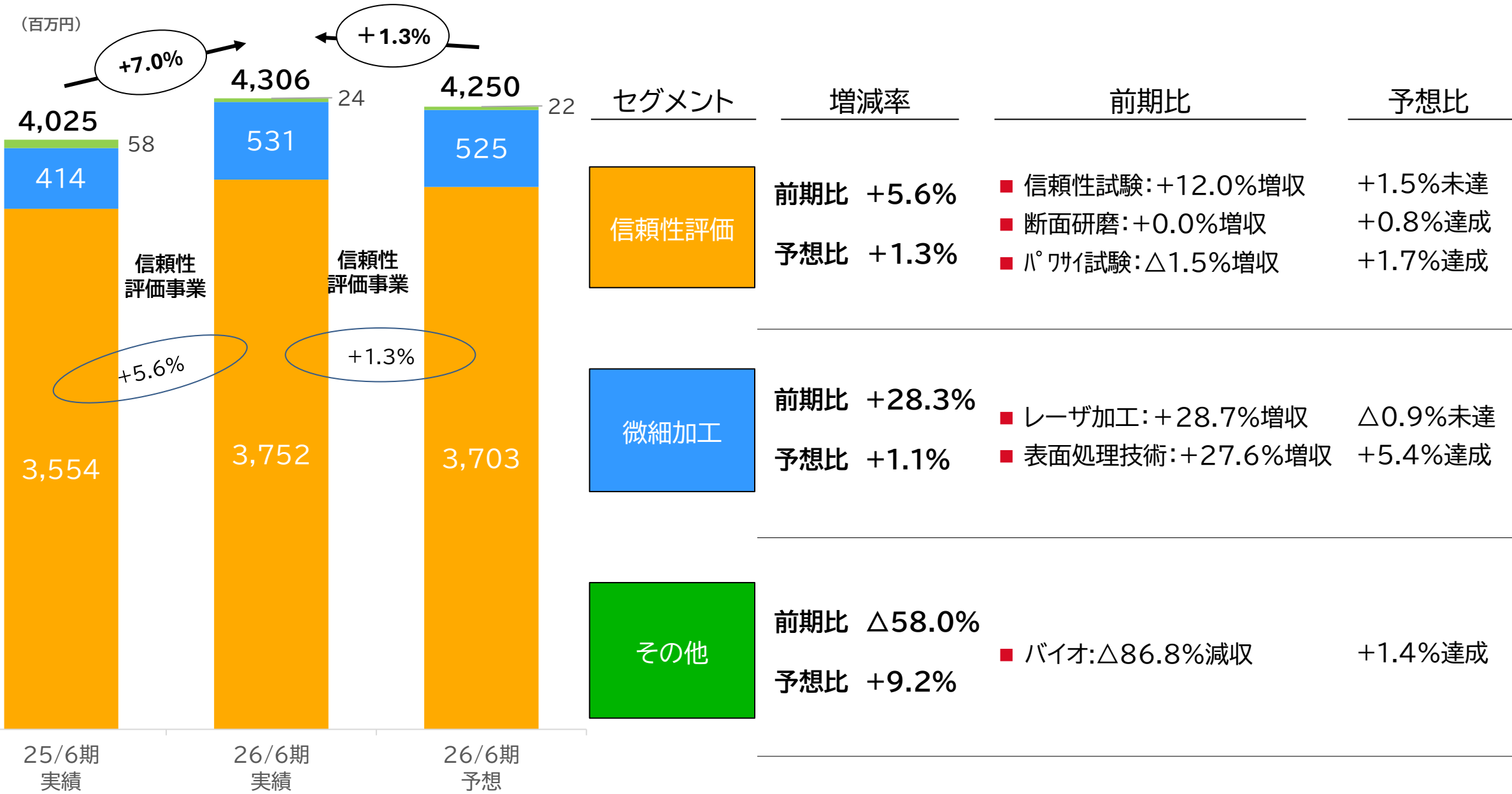
売上高の推移

当社主力事業である信頼性評価事業は順調に成長
2027年6月期業績予想については、前期比6.8%成長を目指す



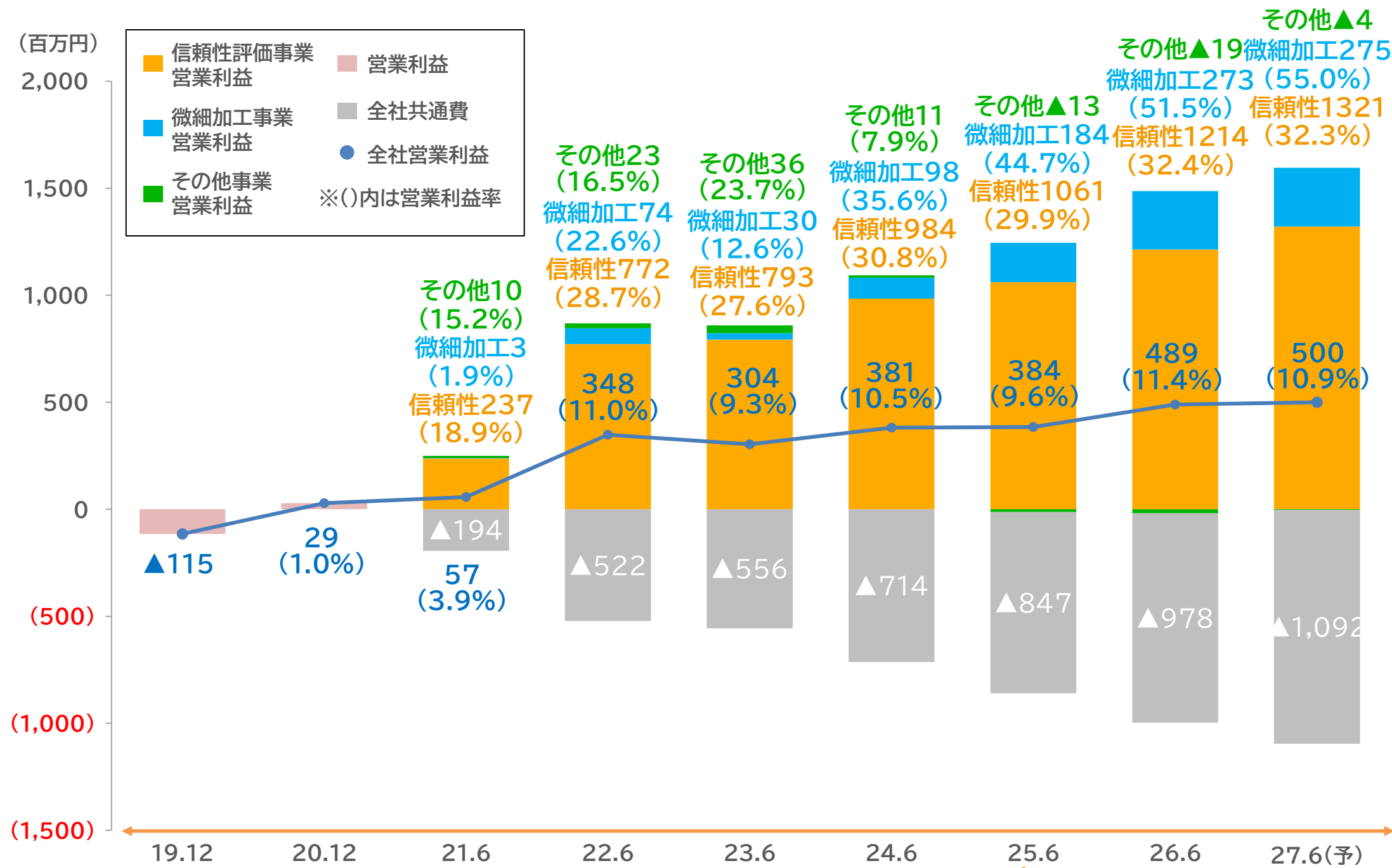
販売概況 セグメント別売上高(前期比/予想比)

全社売上高は全セグメントで成長を図り、前期比+7.0%増収、予想比+1.3%増収達成。
信頼性評価事業は信頼性試験を中心に好調に推移し、前期比+5.6%増収、予想比+1.3%増収達成。
微細加工事業はレーザ加工が好調に推移し、前期比+28.3%増収も、予想比+1.1%減収未達。
その他事業はバイオ信頼性試験が完了したことにより縮小し、前期比△58.0%減収、予想比+9.2%増収達成。



営業利益の推移

2026年6月期は過去最高売上・利益を達成、2027年6月期業績も増収増益を予想。



変則決算のため
6ヶ月分の数字

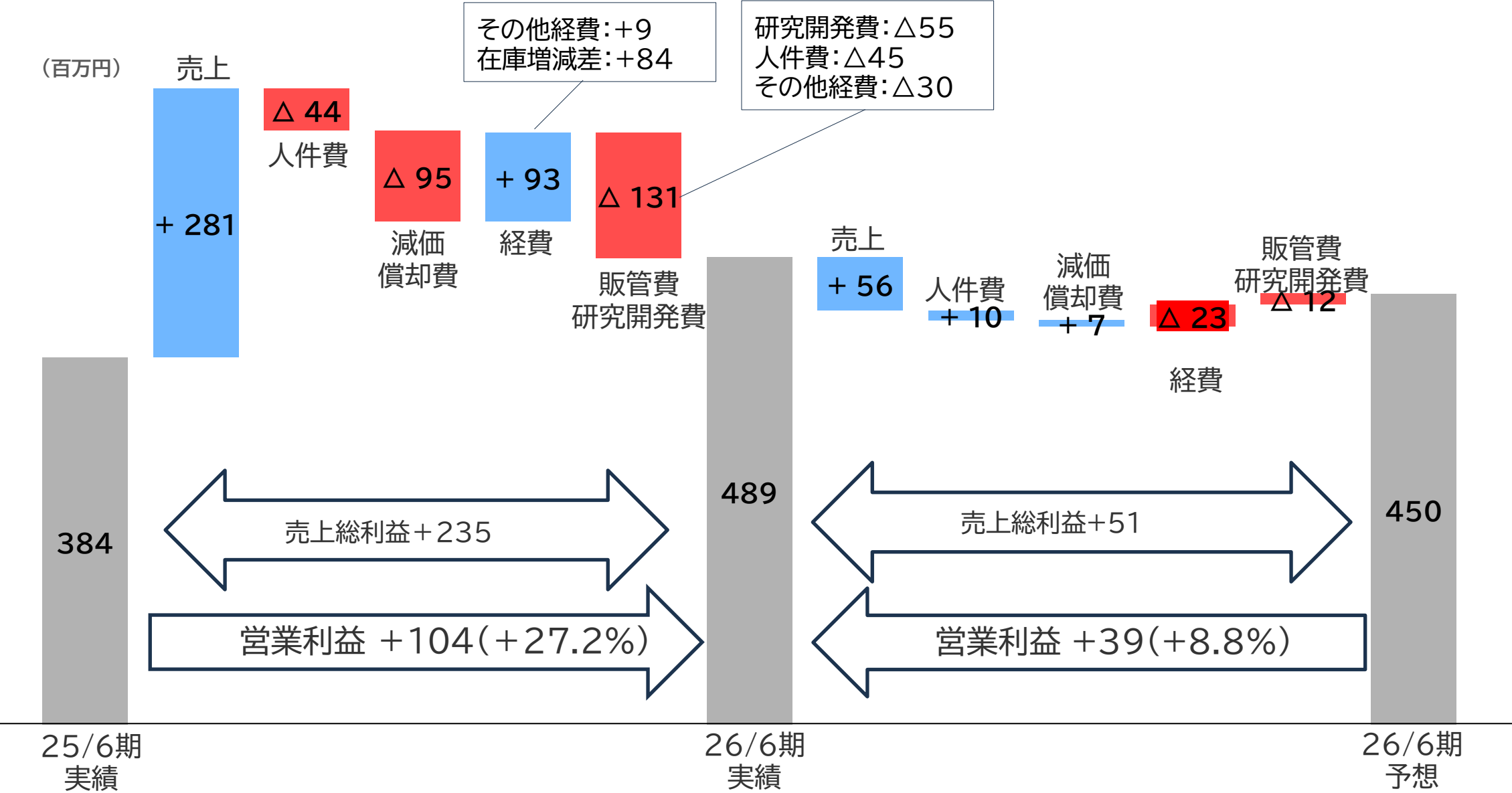
表面処理
その他→微細加工
へセグメント変更

微細加工事業の基板
評価→信頼性評価事
業へセグメント変更

営業利益増減分析(前期比/予想比科目別)

営業利益は対前期比+104百万円(+27.2%)増益の489百万円。研究開発を積極的に進めたことで、研究開発費の増加が影響したものの、売上高+281百万円増収により売上総利益は+235百万円増益。上記要因が、MAPプロジェクトやその他研究開発の推進等も含めた、販管費・研究開発費増△131百万円をカバー。

対予想比は概ね達成。売上高+56百万円増収及び各種費用抑制を推進により+39百万円(+8.8%)増益。



経営目標の見直しについて

昨年までの目標につきまして、事業環境の変化と成長機会の拡大を踏まえ、**2030年を見据えた企業価値最大化を目的**として、見直しました。

1. 従前目標及び達成率

項目	24－27/6期目標	26/6期実績	達成率	27/6期予想	達成率(見込)
売上高	36億円→50億円	43億円	86.1%	46億円	92.0%
営業利益率	10.5%以上→10%以上	11.3% (4.9億円)	113.0%	10.8% (5億円)	100.8%
設備能力※	30%以上増強	17.9%増強	59.7%	31.6%増強	105.3%
人員	242人→30%増強(314人)	261人	83.1%	289人	92.0%
シェア	信頼性事業シェア13→15%	13.5%	89.7%	14.4%	96.0%

※有形固定資産取得価格合計の伸び率

2. 見直し内容

(1)売上

年成長率10%以上を目標としておりましたが、さらなる成長には設備・人員に加え、新拠点と新しい事業の柱が必要な状況が見えてまいりました。2030年に向けて、オーガニックな成長に加え、新拠点開設や、評価装置事業拡大、M&A等の非連続の成長要素に注力いたします。

(2)営業利益率

10%以上を目標としておりましたが、26/6期は信頼性評価事業での高単価案件や微細加工事業での量産案件に加え、パワエレクトロセンタの稼働やAI活用等にて、11.3%へ向上しました。今後とも効率化を進めます。(なお、従来目標の営業利益額5億円は達成見通しです)

(3)設備能力

27/6期は9億円投資の予定。新拠点の設置も含め、2030年に向けて再加速してまいります。

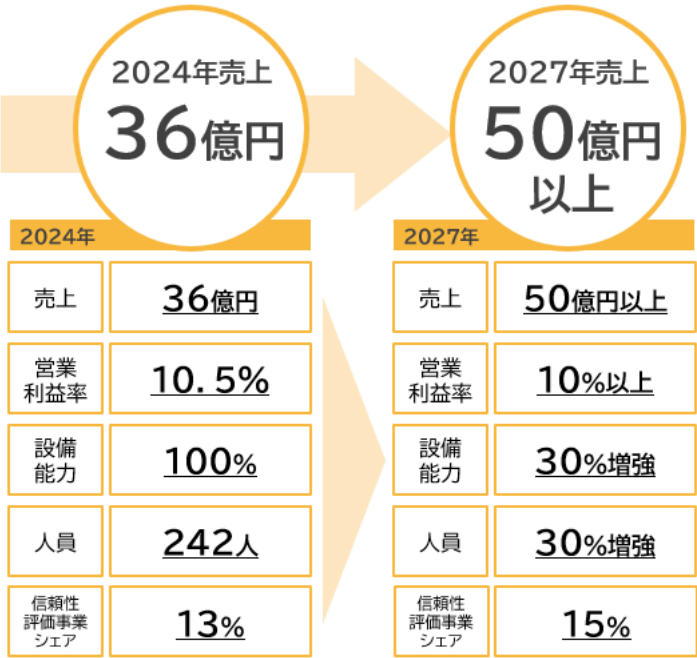
(4)人員

必要人員を確保・教育しつつ、AI/DXの活用、最新設備導入等で、効率化を進めてまいります。

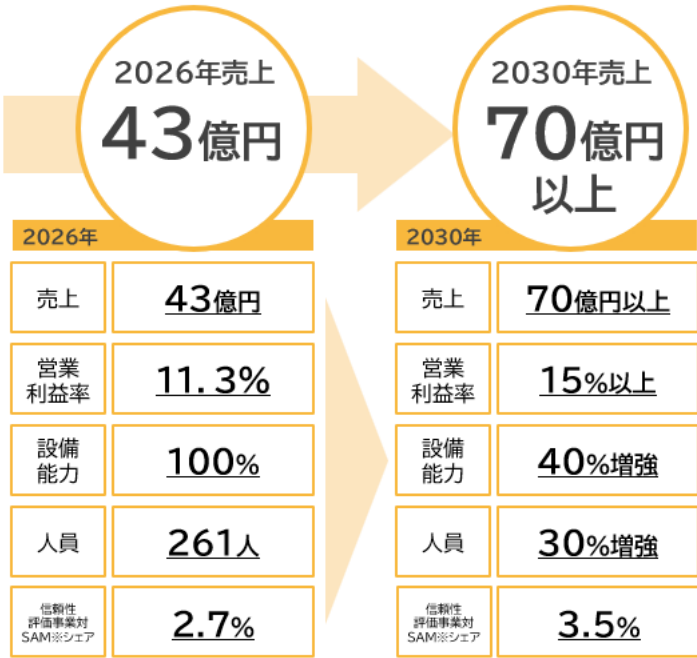
(5)シェア

26/3月に外部コンサル会社のご協力を得て、市場を再調査しました。
P27の記載のとおり、当社が拡大を目指す国内分析・信頼性評価サービスの外注市場 (SAM:エレクトロニクス分野)を再定義し、市場成長を超えるパフォーマンスを目指します。

事業機会を捉え、成長の可能性を広げる

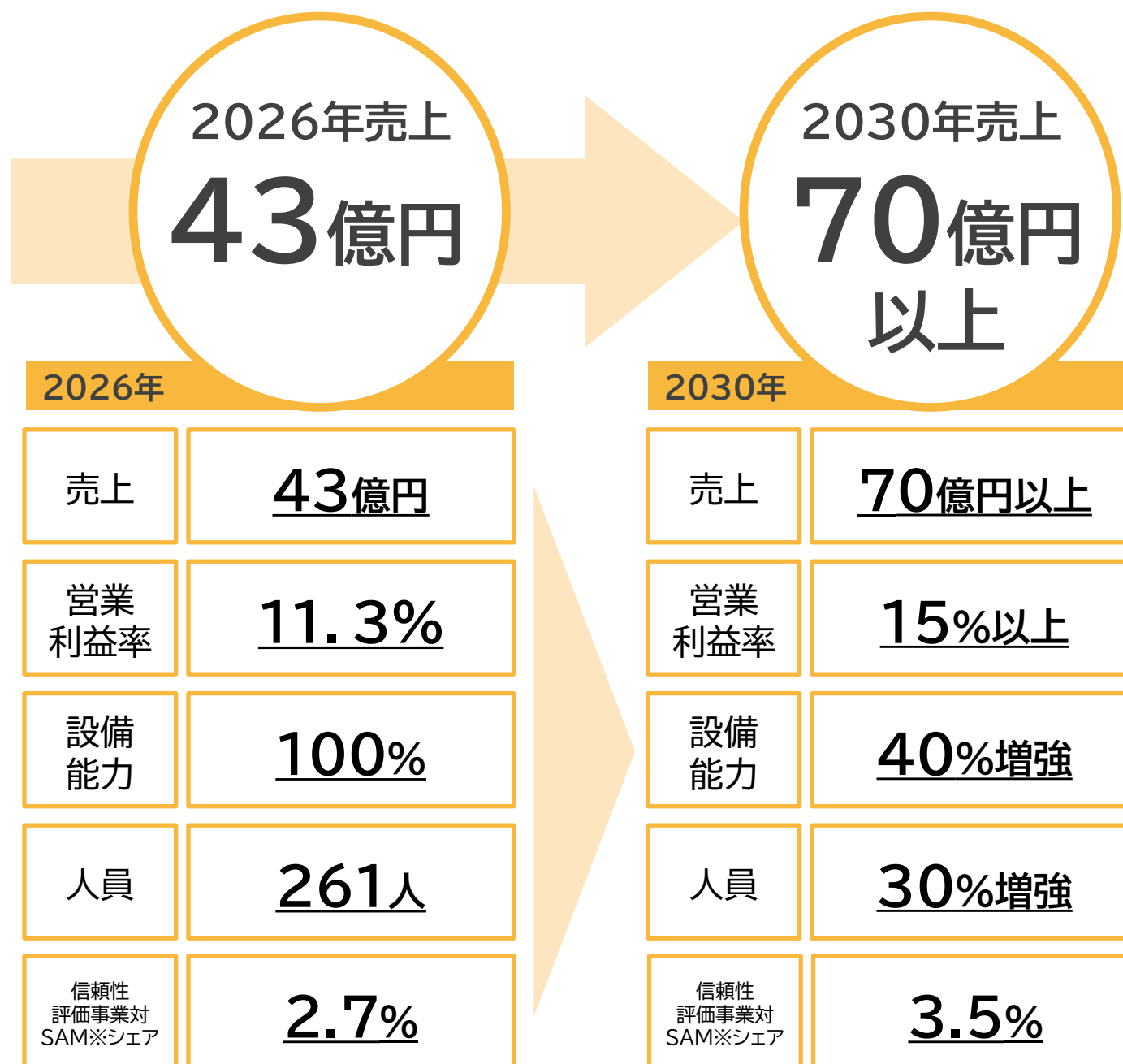


2030年を見据えて見直し (詳細はP50に記載)



新・中期2027-2030年経営目標

事業機会を捉え、成長の可能性を広げる



※SAM(Serviceable Available Market:サービス提供可能市場)
今回外部コンサル会社の支援を得て新たに推計。日本国内の分析・信頼性評価サービス事業のうち、エレクトロニクス分野のマーケット。

1. 中期目標内訳

- 全社売上:70億円以上 26-30CAGR 12.9%
各部門オーガニック成長6~10%に加え、事業領域を拡大。
・信頼性評価事業:59億円以上 26-30CAGR 13.8%
→装置事業を新しい柱として事業領域を拡大。
・微細加工事業:9億円以上 26-30CAGR 14.3%
→従来に加えヘルスケア、データセンター需要等に対応。
・その他事業:2億円以上 26-30CAGR 16.6%
→新規事業・技術・事業提携・M&A等で拡大。
・27/6期46億円、28/6期52億円、29/6期58億円
⇒30/6期70億円

2. 営業利益率

- ・高付加価値案件の獲得、自動化及びAI/DXにより生産性向上を継続し、営業利益率 11.3%→15%を目指します。

3. 設備投資

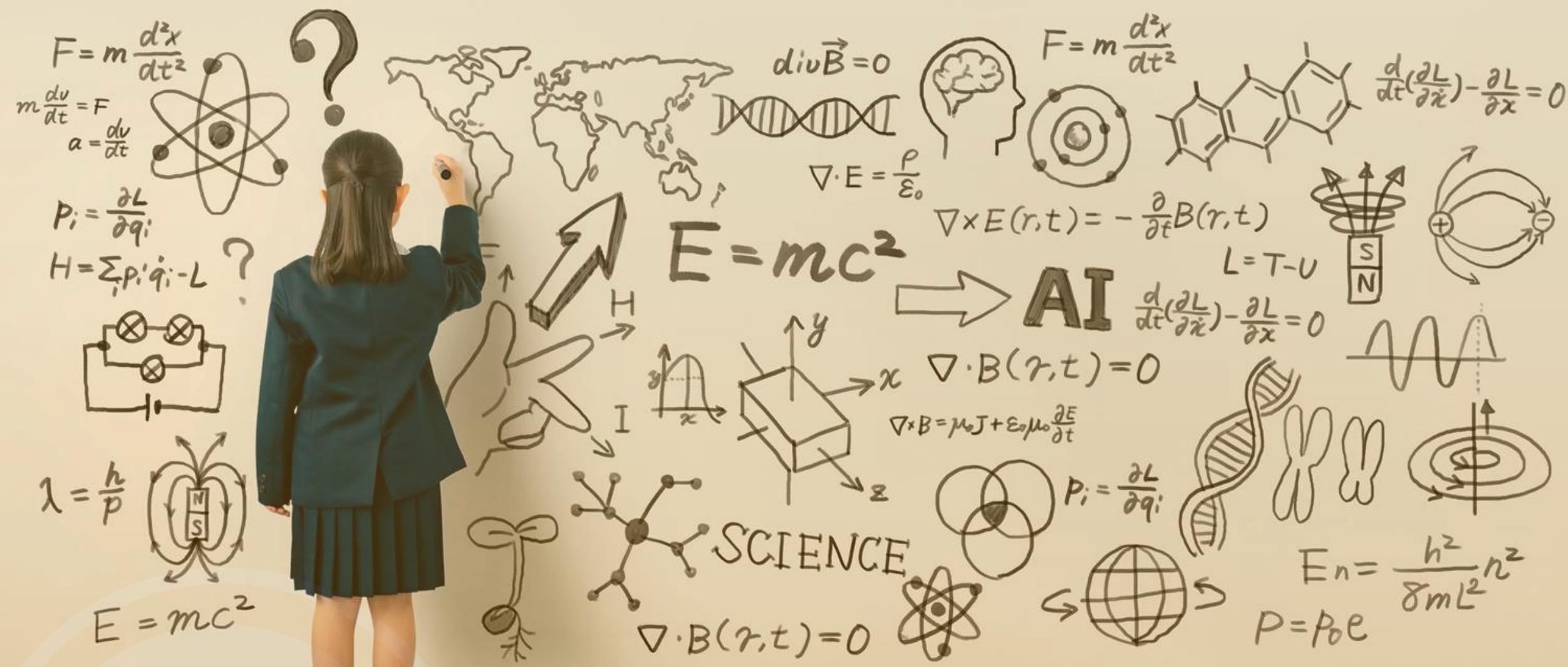
- ・26-30で有形固定資産残高140%以上を見込む
2030年をピークとすべく、27/6期は9億円の投資を予定、28年以降に大阪・名古屋等の新拠点開設も計画。

4. 研究開発費について

- ・26/6期実績2.3億円、対売上比率5.4%
次世代技術開発を止めることなく、売上対比5%を維持。

5. 信頼性評価事業対SAMシェア

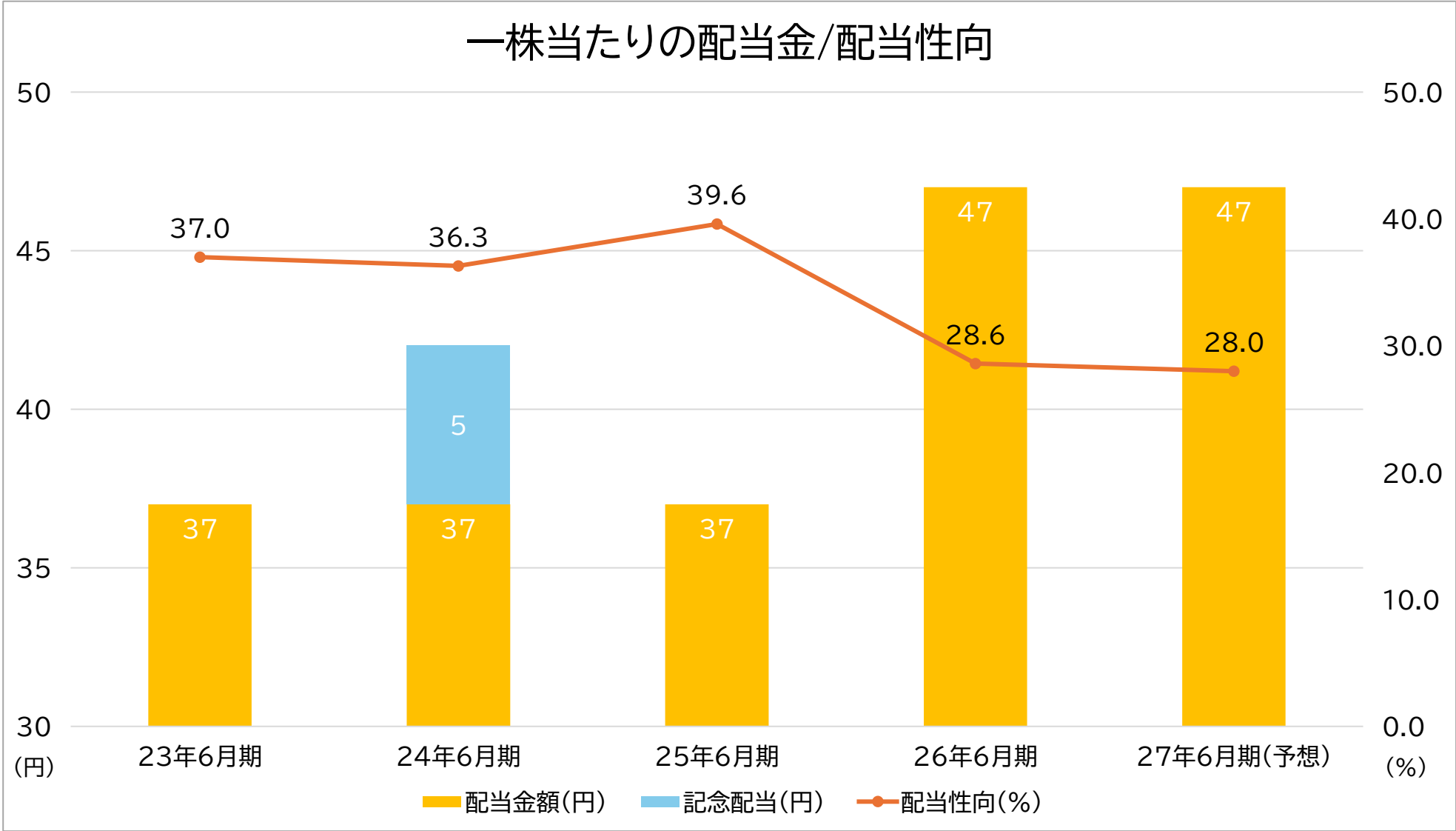
- ・上記に加え、営業面の強化にて、市場成長を上回るシェア増加を目指します。



05 | まとめ

一株当たり配当金推移/配当性向

持続的な成長と財務健全性を重視し、安定した配当を実施してきました。
今後も業績動向を踏まえつつ、適切な利益還元を行いながら、
株主の皆さまへの安定的な配当を継続する方針です。



事業を通じた貢献

企業が社会的および環境的な責任を果たすことを通じて、持続可能な発展を目指すための枠組みであるESG（Environment:環境、Social:社会、Governance:企業統治）。当社でもこれらに係る社会的課題を解決させることにより、サステナビリティ戦略での実行可能なフレームワークとして機能させることを目指します。

社会貢献活動:堺市教育委員会「企業による学びの応援プログラム」の一環として、当社より講師派遣。

サステナビリティに関する指標(26/6期実績)

離職率6.6%(25/6期7.9%、目標5%以内)、男性の育児休業取得率66.7%(25/6期100.0%、目標80%以上)

BCP

基本方針・対応
マニュアルの見直し

CSR

組織の透明性や
倫理、行動規範の尊重

情報セキュリティ

機密性、完全性、
可用性を高める

環境

廃棄物の分別と
リサイクルの徹底

IR

ステークホルダーとの
定期的な
コミュニケーション

統制

コンプライアンス
体制の強化

社会

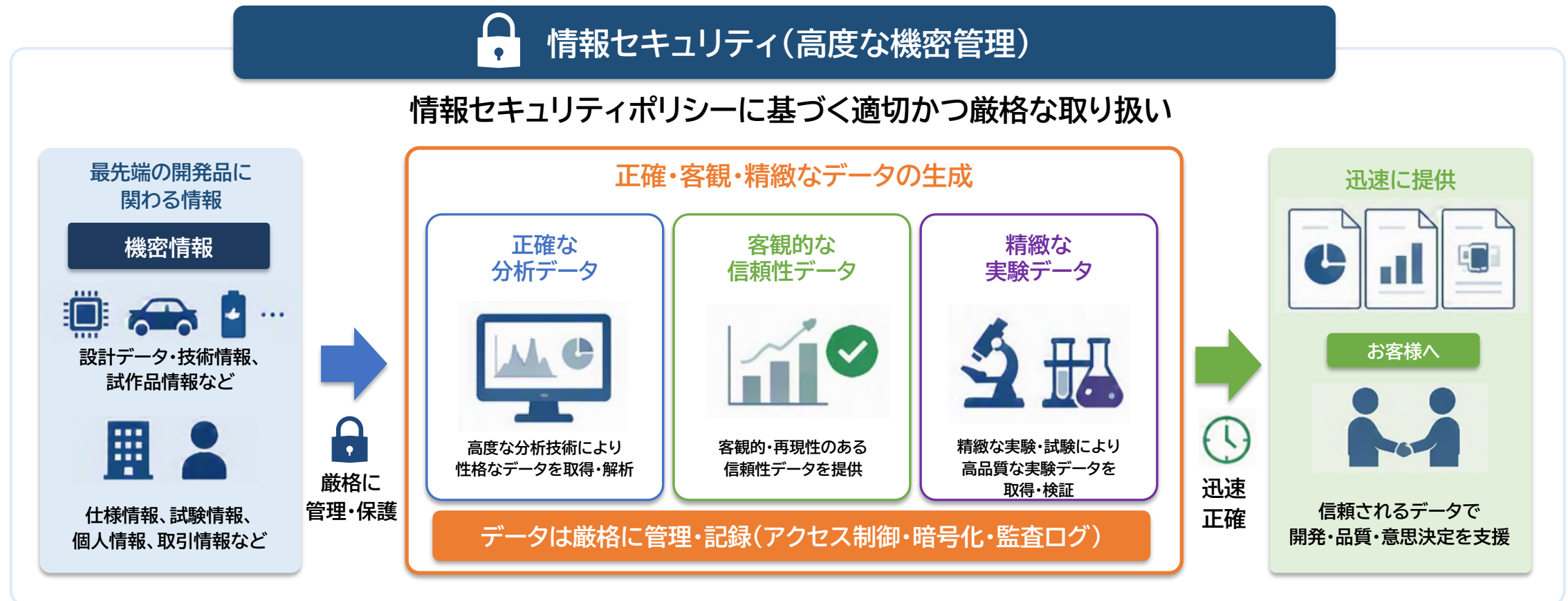
「企業による学びの応援
プログラム」への参加

人的資本

教育・育成、
社内環境整備、
男性育休取得率等

情報セキュリティ管理体制

最先端の開発品に関わる企業として、高度な機密管理のもと、正確な分析データ、客観的な評価データを迅速に提供しています。お客様に関わる有形・無形の情報を適切かつ厳格に取り扱うことを情報セキュリティポリシーとして掲げ、継続的な管理体制の強化に取り組んでいます。



情報セキュリティポリシー

お客様に関わる有形・無形の情報を適切にかつ厳格に取り扱う

適切で厳格な管理

アクセス制御・権限管理・暗号化などの徹底

従業員の意識向上

教育・研修の継続実施と意識の定着

ルール・体制の整備

ポリシー・規程の整備と運用の徹底

監視・モニタリング

継続的な監視と脅威への迅速な対応

継続的な改善

定期的な見直しと改善により管理体制を強化

高度な機密管理のもと、客観性の高いデータを迅速に提供し、社会とお客様の価値創造に貢献します

ESGの具体的な取組み

Environment:環境、**Social:社会**、**Governance:企業統治**、に対し、SDGsを念頭に活動

12 つくる責任
つかう責任

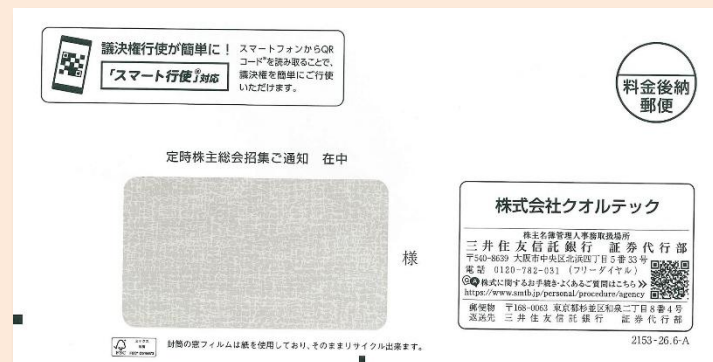


13 気候変動に
具体的な対策を



【環境配慮プロジェクト】

クオルテックの事業活動が、環境に悪影響を及ぼさないようにするための方策を、当プロジェクトでは提案・実行していきます。限りある資源を有効活用するため、**定時株主総会招集ご通知で使用する封筒を、再生紙を利用したものに変更**しました。他にはお客様にサンプルをご返却する際に使用している梱包用の段ボール箱や、ノベルティとして配布したカレンダーについても再生紙を使用したものに変更するなど、プロジェクトを着々と進行しています。



定時株主総会招集ご通知用封筒



梱包用段ボール箱



卓上カレンダー

【今後の取組み】

印刷フライヤーやパンフレット類などにも再生紙の使用を検討。



FSC認証は、経済的にも継続可能な森林管理を推進することを目的とした国際的な認証制度です。

ESGの具体的な取組み

Environment:環境、**Social:社会**、Governance:企業統治、に対し、SDGsを念頭に活動

4 質の高い教育を
みんなに



8 働きがいも
経済成長も



【地域貢献プロジェクト】 堺市教育委員会 企業による学びの応援プログラム

堺市教育委員会では、企業等と連携・協働し、講師派遣をはじめとした「地域貢献活動(CSR活動等)」を学習プログラムとして登録し、学校園やPTA、放課後児童対策事業所などで行われる子どもから大人までを対象とした様々な教育活動に提供することで、学校教育活動や地域活動の活性化を支援しています。



堺市立光竜寺小学校
のびのびルームでの模様(2025年7月)

【今後の取組み】 堺市教育委員会 との関係強化

「企業による学びの応援プログラム」に、講師派遣プログラムを引き続き掲載します。また教育委員会を通して、堺市一円の小中学校からの相談を受け付けすることで、地域の学びに貢献します。

1 貧困を
なくそう



3 すべての人に
健康と福祉を



【交通遺児への寄付】

当社は自動車メーカーと共に、車の品質安全を保証し、交通事故ゼロを目指す立場です。関わりのある自動車における事故で亡くなられたり、重度の後遺障害になられた方の残されたお子さんに対して、学資を貸与することで教育の機会均等を図り、社会有用の人材を育成できる機関を選定。残された遺族の経済的事情により、勉強を続けられなかったり、大学に行けないといった壁を乗り越えやすくするためにも寄付は必要であると考えます。お子さんの立ち上がる力を支援します。

2026年度も昨年から引き続き

①交通遺児育英会 ②大阪交通災害遺族会 の2団体を選定し、寄付を実施しました。



【今後の取組み】 寄付の継続活動

企業としての責任を果たすべく、社会貢献活動を引き続き実行します。2026年-2027年も同様、2機関への寄付を実施する予定です。

2団体から頂いた書状

IR戦略

技術力を基盤とした企業価値向上のストーリーを明確に伝達



企業価値の “認知と共感”を拡大

- ・専門性の見える化
- ・社会性・ESGの訴求

【主な施策】

- ・決算説明会、株主総会、IRフェア、IRメディアなどを通じたメディア露出の年間化
- ・パンフレット、Web、IR資料を統一トーンで再構築
- ・人材・地域共創ストーリー(堺発、半導体共創、未来技術貢献)の継続発信



企業価値の “理解と信頼”を深化

- ・ストーリー型IRの確立
- ・定性＋定量の開示強化
- ・投資家との結びつき深化

【主な施策】

- ・「PR TIMES STORY」の積極利用により、技術×成長テーマを発信
- ・新規投資家向けIRフェアへの参加
- ・新規IRメディア(ログミー/note)の利用
- ・IRサイト内投資家Q&Aページで透明性強化

ESG戦略

目的：サステナビリティへの取り組みをアピールし、企業の社会的責任を果たす

具体策：ESG/SDGsに関連した広報活動の強化、関連イベントの企画・実施



●社内人材教育 ESGおよびSDGsに関連する教育の企画推進を行うことで、社員一人一人が取り組めることを考える機会を創出。

当社の強み

信頼性評価事業

独立系検査会社

信頼性評価事業

評価装置メーカーとして進化

信頼性評価事業

トヨタ・デンソーをはじめとした
自動車・半導体業界大手企業が顧客

微細加工事業

高難度の加工も実現する技術力と
徹底した品質管理

信頼性評価事業

約190種の幅広い試験メニュー

研究開発

MAPプロジェクト進捗良好

信頼性評価事業

最先端の設備をはじめ、
110種、700台以上設備保有

研究開発

AI検査技術の実用化

信頼性評価事業

知見の蓄積、技術力の錬磨
品質、コスト、改善提案力に優位性

ESG/SDGs

節約・節電、環境負荷低減、省エネ
出前授業、寄付、障がい者採用等取組み

長期目標

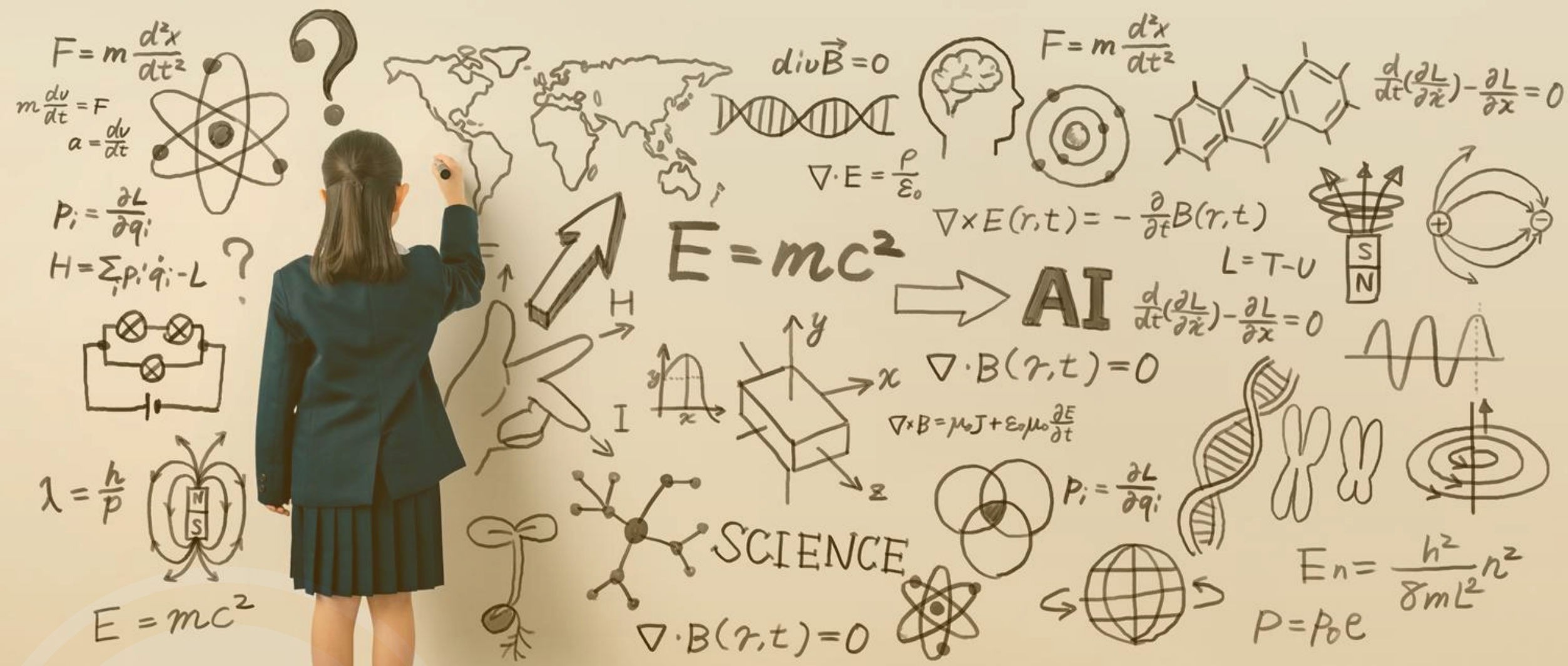
トータル・クオリティ・ソリューションの
進化を続けることで、
全社成長を目指します



目指す姿



“未来品質”の創造を通じて、
社会を支える技術基盤としての役割を果たしていきます。
投資家の皆さまと共に、長期的な企業価値向上を目指します。



06 | 附錄

事業等のリスク①

当社が経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があるとして認識している事業等のリスク(抜粋)は、以下の通りであります。

なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであります。

こちらに記載以外のリスクについては、有価証券報告書の「事業の状況＞3【事業等のリスク】」をご参照ください。

リスク項目	リスクの内容	対応策
①市場環境に関するリスク		
自動車業界の構造変化に伴う業績変動リスク (顕在化の可能性:中/影響度:大/発生時期:特定時期なし)	自動車業界の構造の変化 ・研究開発の動向及び生産動向の大幅な変動、並びに他業種企業が同業界に新規参入することにより既存の同業界企業との間でシェア争いにより、当社の経営成績及び財政状態に影響	・積み上げてきた実績・技術を背景とした顧客基盤の拡充 ・新たな分野への進出による事業拡大により、同業界への依存度を低減
競合他社、新規参入に関するリスク (顕在化の可能性:中/影響度:大/発生時期:特定時期なし)	新規参入企業の増加や当社の技術力を上回る国内外の企業が出現 ・市場競争が激化し、当社が市場における競争力を維持できない場合や、顧客が競合他社のサービスに移行した場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響	・独立系検査会社であり第三者機関としての責務を果たすため、日々技術力の向上に努め、顧客の高水準のニーズに対応することで、競合他社と比較して優位性を確保 ・既存顧客との関係強化や新規顧客への取引拡大により、各事業における競争優位性を維持・向上させる事業活動
②事業に関するリスク		
特定顧客への依存リスク (顕在化の可能性:中/影響度:大/発生時期:特定時期なし)	信頼性評価事業における自動車業界の顧客向けの売上割合 ・同社グループの業績等が変動した場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響	・新たに見込まれる需要の取り込み ・自動車業界以外への業界シェア拡大
人材確保及び育成に関するリスク (顕在化の可能性:中/影響度:大/発生時期:特定時期なし)	少子高齢化による労働人口の減少 ・計画通りの人材確保・育成が困難	・優秀な人材の確保・人材育成 ・安全で働きやすい職場環境づくり・社員教育

事業等のリスク②

リスク項目	リスクの内容	対応策
③法的規制に関するリスク		
コンプライアンスに関するリスク (顕在化の可能性:中／影響度:大／発生時期:特定時期なし)	・社会的信頼の喪失 ・従業員の身体的、精神的不安や金銭的損害	・コンプライアンス規程を整備 ・法令遵守の啓蒙活動や内部監査などを通じた検証
知的財産権に関するリスク (顕在化の可能性:中／影響度:大／発生時期:特定時期なし)	・保護が不十分であった場合あるいは違法に侵害される被害 ・他社の有する知的財産権を侵害したと認定され、損害賠償等の責任を負担	・特許権の取得により知的財産権の保護
④その他のリスク		
災害の発生等によるリスク (顕在化の可能性:中／影響度:大／発生時期:特定時期なし)	・地震等の自然災害や火災・事故等による、従業員や試験設備等の被害 ・売上高の減少や試験設備等の修復又は代替のための費用の発生	-
地政学的リスク (顕在化の可能性:中／影響度:大／発生時期:特定時期なし)	・物価の高騰や為替相場の変動等により景気動向が減速 ・顧客の業績悪化、投資行動の急激な変化	-

注意事項

本資料には、将来の見通しに関する記述が含まれています。

これら将来の見通しに関する記述は、当該記述を作成した時点における情報に基づいて作成されています。これらの記述は、将来の結果や業績を保証するものではありません。このような将来予測に関する記述には、必ずしも既知および未知のリスクや不確実性が含まれており、その結果、将来の実際の業績や財務状況は、将来予想に関する記述によって明示的または黙示的に示された将来の業績や結果の予測とは大きく異なる可能性があります。

上記の実際の結果に影響を与える要因としては、国内および国際的な経済状況の変化や、当社が事業を展開する業界の動向などが含まれますが、これらに限られるものではありません。

また、当社以外の事項・組織に関する情報は、一般に公開されている情報に基づいており、当社はそのような一般に公開されている情報の正確性や適切性を検証しておらず、保証しておりません。

次回の「事業計画及び成長可能性に関する事項」は、2027年8月に開示する予定です。

assists your "thinking"

Qualtec

